

Modulhandbuch

Master of Science (M.Sc.)

Microelectronics and Microsystems

Kohorte: Wintersemester 2021

Stand: 31. Mai 2024

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Studiengangsbeschreibung	3
Fachmodule der Kerngualifikation	5
Modul M0523: Betrieb & Management	5
Modul M0524: Nichttechnische Angebote im Master	6
Modul M0676: Digitale Nachrichtenübertragung	8
Modul M1048: Integrated Circuit Design	10
Modul M0746: Microsystem Engineering	12
Modul M0768: Microsystems Technology in Theory and Practice	14
Modul M1137: Technischer Ergänzungskurs für IMPMM - Bereich ET (laut FSPO)	16
Modul M0918: Advanced IC Design	17
Modul M0761: Halbleitertechnologie	19
Modul M0747: Microsystem Design	21
Modul M1131: Technischer Ergänzungskurs für IMPMM - Bereich TUHH (laut FSPO)	23
Modul M1130: Projektarbeit IMPMM	24
Modul M1591: Seminar for IMPMM	25
Fachmodule der Vertiefung Communication and Signal Processing	26
Modul M0710: Hochfrequenztechnik	26
Modul M0836: Communication Networks	28
Modul M1700: Satellite Communications and Navigation	30
Modul M1743: COSIMA (Competition in Microsystem Application)	31
Modul M0637: Advanced Concepts of Wireless Communications	32
Modul M1686: Selected Aspects of Communication and Signal Processing	34
Modul M1598: Bildverarbeitung	35
Modul M0738: Digital Audio Signal Processing	37
Modul M1249: Medizinische Bildgebung	39
Modul M0677: Digital Signal Processing and Digital Filters	41
Modul M1743: COSIMA (Competition in Microsystem Application)	43
Fachmodule der Vertiefung Embedded Systems	44
Modul M0791: Rechnerarchitektur	44
Modul M0924: Software für Eingebettete Systeme	46
Modul M1400: Entwurf von Dependable Systems	48
Modul M1743: COSIMA (Competition in Microsystem Application)	50
Modul M0803: Embedded Systems	51
Modul M0925: Digital Circuit Design	53
Modul M1687: Selected Aspects of Embedded Systems	54
Modul M1743: COSIMA (Competition in Microsystem Application)	55
Modul M0910: Fortgeschrittener Entwurf von Chip-Systemen (Praktikum)	56
Modul M1842: GPU Architectures	57
Fachmodule der Vertiefung Microelectronics Complements	59
Modul M1611: Silicon Photonics	59
Modul M0925: Digital Circuit Design	61
Modul M0921: Electronic Circuits for Medical Applications	62
Modul M0769: EMV I: Kopplungen, Gegenmaßnahmen und Prüfverfahren	65
Modul M1743: COSIMA (Competition in Microsystem Application)	67
Modul M0919: Laboratory: Digital Circuit Design	68
Modul M0645: Fibre and Integrated Optics	70
Modul M0643: Optoelectronics I - Wave Optics	72
Modul M1688: Selected Aspects of Microelectronics and Microsystems	74
Modul M0781: EMV II: Signalintegrität und Spannungsversorgung elektronischer Systeme	75
Modul M0913: Mixed-signal Circuit Design	78
Modul M1589: Laboratory: Analog Circuit Design	80
Modul M0644: Optoelectronics II - Quantum Optics	82
Modul M1743: COSIMA (Competition in Microsystem Application)	84
Thesis	85
Modul M-002: Masterarbeit	85
- 1000 1 1 000 1 MOIL	

Studiengangsbeschreibung

Inhalt

Die Mikroelektronik, oder besser gesagt Nanoelektronik, da die minimalen Strukturgrößen zahlreicher in Großvolumina produzierten integrierten Schaltungen nur noch im Bereich von 20 Nanometer und darunter liegen, ist die Basis für die Produkte, die als Innovationen der vergangenen Jahre das tägliche Leben der Menschheit stark beeinflussen. Als Beispiele seien nur genannt der Personal Computer und das Smartphone, die beide mit Internetanbindung neue Dimensionen der Kommunikation und Information erschließen. Auch in der Medizin sind diagnostische Verfahren wie Computer und Kernspintomographie oder intelligente Implantate nur mit moderner Nanoelektronik und Mikrosystemtechnik in der erforderlichen Leistungsfähigkeit realisierbar.

Grundlage für die Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik ist die Halbleitertechnologie. Deshalb ist es die Zielsetzung des Internationalen Masterstudiengangs "Microelectronics and Microsystems", den Studierenden fundiertes Wissen auf physikalischer Ebene über die elektronischen Vorgängen in halbleitenden Materialien, vorwiegend Silizium, in Hinblick auf Bauelemente und deren Anwendungen und Herstellungsverfahren zu vermitteln sowie sie in der Technologie und Funktionsweise der Mikrosystemtechnik auszubilden. Sie sollen nicht nur die aktuellen Bauelemente und Prozesse in ihrem Aufbau, ihrer Herstellung und Wirkungsweise verstehen, sondern auch in kritischer Weise das Problempotenzial, das mit dem Übergang zu kleineren Strukturen entsteht, erkennen können. Darüber hinaus sollen sie eine Vorstellung entwickeln, in welche Richtung Maßnahmen zielen müssen, um einer Lösung solcher Probleme näher zu kommen. Dadurch werden sie befähigt, die weitere Strukturverkleinerung mit ihrem Potenzial - aber auch ihren Einschränkungen - zu verstehen, um diesen Prozess, der ihr Berufsleben begleiten wird, aktiv auf technologischer oder Anwenderseite mit zu gestalten.

Neben der wichtigen Rolle der physikalischen Grundlagen nimmt eine genaue Kenntnis der prozessabhängigen Herstellungsverfahren eine Schlüsselrolle ein, um den Studierenden sowohl in der Mikroelektronik als auch in der Mikrosystemtechnik das Rüstzeug mitzugeben, mit dem sie in der beruflichen Praxis neue Lösungen konzipieren und diese dann in funktionsfähige Systeme umsetzen können.

Der Internationale Masterstudiengang "Microelectronics and Microsystems" qualifiziert die Studierenden für eine wissenschaftlich ausgerichtete Berufstätigkeit im Bereich der Elektrotechnik und Informationstechnik, wobei sich das Berufsfeld von der Entwicklung über die Herstellung und Anwendung bis zur Qualitätssicherung von komplexen Systemen mit hochintegrierten Schaltkreisen und mikrosystemtechnischen Komponenten erstrecken kann. Beide Gebiete wachsen mehr und mehr zusammen, da eine schnell steigende Anzahl neuer komplexer Anwendungen die Integration von Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik in einem System erfordert.

Insbesondere soll der Studiengang dazu befähigen, nicht nur neue komplexe Systeme für innovative Anwendungen zu entwerfen sondern diese auch produktorientiert nutzbar zu machen. Dabei steht die Vermittlung von ingenieurwissenschaftlicher Methodik auf physikalischer Basis sowohl in den theoretischen als auch in den anwendungsorientierten Lehrveranstaltungen im Vordergrund.

Berufliche Perspektiven

Die Absolventinnen und Absolventen des Internationalen Masterstudiengangs "Microelectronics and Microsystems" finden ein sehr breitgefächertes berufliches Umfeld vor, da sie sowohl fundiertes Wissen für den Entwurf, die Anwendung und auch für die Herstellung hochintegrierter Schaltkreise der Mikroelektronik und von Mikrosystemen in ihrem Studium erworben haben. Potenzielle Arbeitgeber sind deshalb einerseits Großfirmen mit internationalen Standorten für die Produktion von integrierten Schaltungen, aber auch mittelständische und kleinere Firmen im Bereich der Mikrosystemtechnik.

Ein vielfältiges Angebot an Arbeitsplätzen gibt es auch im Bereich des Entwurfs sowohl von integrierten Schaltungen als auch von Mikrosystemen. Aufgrund des rapiden Preisverfalls für leistungsfähige Computersysteme kann der Entwurf auch von sehr kleinen Firmen am Rechner durchgeführt werden. In einer Arbeitsteilung wird dann die Herstellung von größeren Firmen übernommen, weshalb der Entwurfsbereich auch in Zukunft eine stabile Säule des Arbeitsmarktes für die Absolventen des Internationalen Studiengangs Microelectronics and Microsystems bleiben wird.

Lernziele

Wissen

- 1. Die Studierenden verstehen die physikalischen Grundprinzipien mikroelektronischer Bauelemente und mikrosystemtechnischer Funktionseinheiten sowie deren Herstellungstechnologie und können diese in voller Breite und Tiefe erläutern.
- 2. Sie haben vertiefte Kenntnisse in ausgewählten Teilgebieten gewonnen zusammen mit einem breiten theoretischen und methodischen Fundament.
- 3. Die Studierenden verfügen über vertiefte Kenntnisse der interdisziplinären Zusammenhänge.
- 4. Sie verfügen über die notwendigen Hintergrundkenntnisse, um ihr Fachgebiet in das wissenschaftliche und gesellschaftliche Umfeld einordnen zu können.

Fertigkeiten

Die Studierenden sind in der Lage

- 1. Berechnungsmethoden zur quantitativen Analyse von Designparametern und zur Entwicklung von innovativen Systemen der Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik anzuwenden.
- 1. komplexe Probleme und Aufgabenstellungen durch grundlagenbasierte methodische Ansätze auch außerhalb der vorgegebenen Lösungsmuster selbständig zu lösen.
- 2. d e n technologischen Fortschritt und die wissenschaftlichen Weiterentwicklungen sowie technische, ökonomische und ökologische Randbedingungen in die Problemlösungen einzubeziehen.

Sozialkompetenz

Die Studierenden sind fähig.

- 1. in interdisziplinären Teams zu arbeiten und prozessorientiert ihre Arbeit zu organisieren als Vorbereitung auf forschungsorientierte Berufstätigkeit und Führungsverantwortung.
- 2. ihre Arbeitsergebnisse schriftlich oder mündlich und auch in internationalen Kontexten zielgruppengerecht zu präsentieren.

Selbstständigkeit

- 1. Die Studierenden können in effektiv selbstorganisierter Weise sich Teilgebiete ihres Faches mit wissenschaftlicher Methodik erschließen.
- 2. Sie sind in der Lage, ihr erlerntes Wissen in eigenständiger Weise mit geeigneten Präsentationstechniken vorzutragen oder in einem Dokument von angemessenem Umfang darzustellen.
- 3. Die Studierenden sind in der Lage, weiteren Informationsbedarf zu erkennen und eine Strategie zu entwickeln, um ihr Wissen selbständig zu

Modulhandbuch M.Sc. "Microelectronics and Microsystems" erweitern.

Studiengangsstruktur

Das Curriculum des Internationalen Masterstudiengangs "Microelectronics and Microsystems" ist wie folgt gegliedert:

- Kernqualifikation:
- Vertiefung: Die Studierenden wählen eine aus den folgenden zwei Vertiefungen:

٠

In ihrer Vertiefung belegen die Studierenden Module im Umfang von insgesamt 18 Leistungspunkten (1. - 3. Semester).

• Masterarbeit mit 30 LP (4. Semester)

Damit ergibt sich ein Gesamtaufwand für das gesamte Studienprogramm von 120 LP.

Fachmodule der Kernqualifikation

Modul M0523: Betrieb	& Management
Mad I am a district	D. C. M. W. C. M. C. C.
Modulverantwortlicher	•
Zulassungsvoraussetzungen	
Empfohlene Vorkenntnisse	
-	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studierenden die folgenden Lernergebnisse erreicht
Lernergebnisse	
Fachkompetenz Wissen Fertigkeiten	 Die Studierenden sind in der Lage, ausgewählte betriebswirtschaftliche Spezialgebiete innerhalb der Betriebswirtschaftslehre zu verorten. Die Studierenden können in ausgewählten betriebswirtschaftlichen Teilbereichen grundlegende Theorien, Kategorien und Modelle erklären. Die Studierenden können technisches und betriebswirtschaftliches Wissen miteinander in Beziehung setzen.
	 Die Studierenden k\u00f6nnen in ausgew\u00e4hlten betriebswirtschaftlichen Teilbereichen grundlegende Methoden anwenden. Die Studierenden k\u00f6nnen f\u00fcr praktische Fragestellungen in betriebswirtschaftlichen Teilbereichen Entscheidungsvorschl\u00e4ge begr\u00fcnden.
Personale Kompetenzen Sozialkompetenz	• Die Studierenden sind in der Lage, in interdisziplinären Kleingruppen zu kommunizieren und gemeinsam Lösungen für komplexe Problemstellungen zu erarbeiten.
Selbstständigkeit	Die Studierenden sind in der Lage, sich notwendiges Wissen durch Recherchen und Aufbereitungen von Material selbstständig zu erschließen.
Arbeitsaufwand in Stunden	Abhängig von der Wahl der Lehrveranstaltungen
Leistungspunkte	6

Lehrveranstaltungen

Die Informationen zu den Lehrveranstaltungen entnehmen Sie dem separat veröffentlichten Modulhandbuch des Moduls.

Modul M0524: Nichttechnische Angebote im Master

Modulverantwortlicher

Dagmar Richter

Zulassungsvoraussetzungen

Keine

Empfohlene Vorkenntnisse Modulziele/ angestrebte

Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studierenden die folgenden Lernergebnisse erreicht

Lernergebnisse Fachkompetenz

Wissen

Die Nichttechnischen Angebote (NTA)

vermittelt die in Hinblick auf das Ausbildungsprofil der TUHH nötigen Kompetenzen, die ingenieurwissenschaftliche Fachlehre fördern aber nicht abschließend behandeln kann: Eigenverantwortlichkeit, Selbstführung, Zusammenarbeit und fachliche wie personale Leitungsbefähigung der zukünftigen Ingenieurinnen und Ingenieure. Er setzt diese Ausbildungsziele in seiner Lehrarchitektur, den Lehr-Lern-Arrangements, den Lehrbereichen und durch Lehrangebote um, in denen sich Studierende wahlweise für spezifische Kompetenzen und ein Kompetenzniveau auf Bachelor- oder Masterebene qualifizieren können. Die Lehrangebote sind jeweils in einem Modulkatalog Nichttechnische Ergänzungskurse zusammengefasst.

Die Lehrarchitektur

besteht aus einem studiengangübergreifenden Pflichtstudienangebot. Durch dieses zentral konzipierte Lehrangebot wird die Profilierung der TUHH Ausbildung auch im nichttechnischen Bereich gewährleistet.

Die Lernarchitektur erfordert und übt eigenverantwortliche Bildungsplanung in Hinblick auf den individuellen Kompetenzaufbau ein und stellt dazu Orientierungswissen zu thematischen Schwerpunkten von Veranstaltungen bereit.

Das über den gesamten Studienverlauf begleitend studierbare Angebot kann ggf. in ein-zwei Semestern studiert werden. Angesichts der bekannten, individuellen Anpassungsprobleme beim Übergang von Schule zu Hochschule in den ersten Semestern und um individuell geplante Auslandsemester zu fördern, wird jedoch von einer Studienfixierung in konkreten Fachsemestern abgesehen.

Die Lehr-Lern-Arrangements

sehen für Studierende - nach B.Sc. und M.Sc. getrennt - ein semester- und fachübergreifendes voneinander Lernen vor. Der Umgang mit Interdisziplinarität und einer Vielfalt von Lernständen in Veranstaltungen wird eingeübt - und in spezifischen Veranstaltungen gezielt gefördert.

Die Lehrbereiche

basieren auf Forschungsergebnissen aus den wissenschaftlichen Disziplinen Kulturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, Kunst, Geschichtswissenschaften, Kommunikationswissenschaften, Migrationswissenschaften, Nachhaltigkeitsforschung und aus der Fachdidaktik der Ingenieurwissenschaften. Über alle Studiengänge hinweg besteht im Bachelorbereich zusätzlich ab Wintersemester 2014/15 das Angebot, gezielt Betriebswirtschaftliches und Gründungswissen aufzubauen. Das Lehrangebot wird durch soft skill und Fremdsprachkurse ergänzt. Hier werden insbesondere kommunikative Kompetenzen z.B. für Outgoing Engineers gezielt gefördert.

Das Kompetenzniveau

der Veranstaltungen in den Modulen der nichttechnischen Ergänzungskurse unterscheidet sich in Hinblick auf das zugrunde gelegte Ausbildungsziel: Diese Unterschiede spiegeln sich in den verwendeten Praxisbeispielen, in den - auf unterschiedliche berufliche Anwendungskontexte verweisende - Inhalten und im für M.Sc. stärker wissenschaftlich-theoretischen Abstraktionsniveau. Die Soft skills für Bachelor- und für Masterabsolventinnen/ Absolventen unterscheidet sich an Hand der im Berufsleben unterschiedlichen Positionen im Team und bei der Anleitung von Gruppen.

Fachkompetenz (Wissen)

Die Studierenden können

- ausgewähltes Spezialgebiete des ieweiligen nichttechnischen Bereiches erläutern.
- in den im Lehrbereich vertretenen Disziplinen grundlegende Theorien, Kategorien, Begrifflichkeiten, Modelle, Konzepte oder künstlerischen Techniken skizzieren,
- diese fremden Fachdisziplinen systematisch auf die eigene Disziplin beziehen, d.h. sowohl abgrenzen als auch Anschlüsse
- in Grundzügen skizzieren, inwiefern wissenschaftliche Disziplinen, Paradigmen, Modelle, Instrumente, Verfahrensweisen und Repräsentationsformen der Fachwissenschaften einer individuellen und soziokulturellen Interpretation und Historizität
- können Gegenstandsangemessen in einer Fremdsprache kommunizieren (sofern dies der gewählte Schwerpunkt im NTW-Bereich ist).

Die Studierenden können in ausgewählten Teilbereichen

- grundlegende und teils auch spezielle Methoden der genannten Wissenschaftsdisziplinen anwenden.
- technische Phänomene, Modelle, Theorien usw. aus der Perspektive einer anderen, oben erwähnten Fachdisziplin befragen.
- einfache und teils auch fortgeschrittene Problemstellungen aus den behandelten Wissenschaftsdisziplinen erfolgreich

Modulhandbuch M.Sc. "Microelectronics and

Microsystems"
 bearbeiten, bei praktischen Fragestellungen in Kontexten, die den technischen Sach- und Fachbezug übersteigen, ihre Entscheidungen zu Organisations- und Anwendungsformen der Technik begründen.
Personale Kompetenzen Sozialkompetenz Die Studierenden sind fähig ,
 in unterschiedlichem Ausmaß kooperativ zu lernen eigene Aufgabenstellungen in den o.g. Bereichen in adressatengerechter Weise in einer Partner- oder Gruppensituation zu präsentieren und zu analysieren, nichttechnische Fragestellungen einer Zuhörerschaft mit technischem Hintergrund verständlich darzustellen sich landessprachlich kompetent, kulturell angemessen und geschlechtersensibel auszudrücken (sofern dies der gewählte Schwerpunkt im NTW-Bereich ist)
Selbstständigkeit Die Studierenden sind in ausgewählten Bereichen in der Lage, die eigene Profession und Professionalität im Kontext der lebensweltlichen Anwendungsgebiete zu reflektieren, sich selbst und die eigenen Lernprozesse zu organisieren, Fragestellungen vor einem breiten Bildungshorizont zu reflektieren und verantwortlich zu entscheiden, sich in Bezug auf ein nichttechnisches Sachthema mündlich oder schriftlich kompetent auszudrücken. sich als unternehmerisches Subjekt zu organisieren, (sofern dies ein gewählter Schwerpunkt im NTW-Bereich ist).

Arbeitsaufwand in Stunden Abhängig von der Wahl der Lehrveranstaltungen

Leistungspunkte 6

Lehrveranstaltungen

Die Informationen zu den Lehrveranstaltungen entnehmen Sie dem separat veröffentlichten Modulhandbuch des Moduls.

Modul M0676: Digital	e Nachrichtenübertragung			
Lehrveranstaltungen				
Titel		Тур	sws	LP
Digitale Nachrichtenübertragung (L	0444)	Vorlesung	2	3
Digitale Nachrichtenübertragung (L		Hörsaalübung	2	2
Praktikum Digitale Nachrichtenüber	1	Laborpraktikum	1	1
Modulverantwortlicher				
Zulassungsvoraussetzungen	Keine			
Empfohlene Vorkenntnisse	Mathematik 1-3			
	Signale und Systeme			
	Einführung in die Nachrichtentechr	nik und ihre stochastischen Methoden		
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die S	Studierenden die folgenden Lernergebnisse erro	eicht	
Lernergebnisse				
Fachkompetenz				
Wissen	Die Studierenden sind in der Lage, moderne digitale Nachrichtenübertragungsverfahren zu verstehen, zu vergleichen und z entwerfen. Sie sind vertraut mit den Eigenschaften linearer und nicht-linearer digitaler Modulationsverfahren. Sie können di Verzerrungen durch Übertragungskanäle beschreiben sowie Empfänger einschließlich Kanalschätzung und Entzerrung entwerfe und beurteilen. Sie kennen die Prinzipien der Single Carrier- und Multicarrier-Übertragung und die Grundlagen wichtige Vielfachzugriffsverfahren.			
Fertigkeiten	Die Studierenden sind in der Lage, ein digitales Nachrichtenübertragungsverfahren einschließlich Vielfachzugriff zu analysierer und zu entwerfen. Sie sind in der Lage, ein hinsichtlich Übertragungsrate, Bandbreitebedarf, Fehlerwahrscheinlichkeit und weiterer Signaleigenschaften geeignetes digitales Modulationsverfahren zu wählen. Sie können einen geeigneten Detekto einschließlich Kanalschätzung und Entzerrung entwerfen und dabei Eigenschaften suboptimaler Verfahren hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Aufwand berücksichtigen. Sie sind in der Lage, ein Single-Carrierverfahren oder ein Multicarrier-Verfahren zu dimensionieren und die Eigenschaften beider Ansätze gegeneinander abzuwägen.			
Personale Kompetenzen				
Sozialkompetenz	Die Studierenden können in fachspezifisc	he Aufgaben gemeinsam bearbeiten.		
Selbstständigkeit	in den Kontext der Vorlesung zu set:	otwendigen Informationen aus geeigneten Liter zen. Sie können ihren Wissensstand mit H Elicker-System) kontinuierlich überprüfen und a	ilfe vorlesungsbeg	leitender Maßnahme
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 110, Präsenzstudium 70			
Leistungspunkte	6			
Studienleistung	Verpflichtend Bonus Art der Studienleistung Ja Keiner Schriftliche Ausark	•		
Prüfung	Klausur	-		
Prüfungsdauer und -umfang	90 min			
Zuordnung zu folgenden	Elektrotechnik: Kernqualifikation: Pflicht			
	Informatik-Ingenieurwesen: Vertiefung II.	Ingenieurwissenschaften: Wahlpflicht		
	Information and Communication Systems	: Vertiefung Kommunikationssysteme: Pflicht		
	Information and Communication Systems	: Vertiefung Sichere und zuverlässige IT-Systen	ne, Schwerpunkt Ne	tze: Wahlpflicht
	Internationales Wirtschaftsingenieurwese	n: Vertiefung II. Informationstechnologie: Wahl	oflicht	
	Internationales Wirtschaftsingenieurwese	n: Vertiefung II. Elektrotechnik: Wahlpflicht		
	Microelectronics and Microsystems: Kerno	qualifikation: Wahlpflicht		

Lehrveranstaltung L0444: Digitale Nachrichtenübertragung				
Тур	Vorlesung			
SWS	2			
LP	3			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28			
Dozenten	Prof. Gerhard Bauch			
Sprachen	DE/EN			
Zeitraum	WiSe			
Inhalt	 Digitale Modulationsverfahren Kohärente und nicht-kohärente Detektion Kanalschätzung und Entzerrung Single-Carrier- und Multicarrierübertragungsverfahren, Vielfachzugriffsverfahren (TDMA, FDMA, CDMA, OFDM) 			
Literatur	K. Kammeyer: Nachrichtenübertragung, Teubner P.A. Höher: Grundlagen der digitalen Informationsübertragung, Teubner. J.G. Proakis, M. Salehi: Digital Communications. McGraw-Hill. S. Haykin: Communication Systems. Wiley R.G. Gallager: Principles of Digital Communication. Cambridge A. Goldsmith: Wireless Communication. Cambridge. D. Tse, P. Viswanath: Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge.			

Lehrveranstaltung L0445: Digitale Nachrichtenübertragung			
Тур	Hörsaalübung		
sws	2		
LP	2		
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 32, Präsenzstudium 28		
Dozenten	Prof. Gerhard Bauch		
Sprachen	DE/EN		
Zeitraum	WiSe		
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung		
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung		

	raktikum Digitale Nachrichtenübertragung
Тур	Laborpraktikum
sws	
LP	1
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 16, Präsenzstudium 14
Dozenten	Prof. Gerhard Bauch
Sprachen	DE/EN
Zeitraum	WiSe
Inhalt	- DSL-Übertragung
	- Stochastische Prozesse
	- Digitale Datenübertragung
Literatur	K. Kammeyer: Nachrichtenübertragung, Teubner
	P.A. Höher: Grundlagen der digitalen Informationsübertragung, Teubner.
	J.G. Proakis, M. Salehi: Digital Communications. McGraw-Hill.
	S. Haykin: Communication Systems. Wiley
	R.G. Gallager: Principles of Digital Communication. Cambridge
	A. Goldsmith: Wireless Communication. Cambridge.
	D. Tse, P. Viswanath: Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge.

Microsystems"				
Modul M1048: Integra	nted Circuit Design			
Lehrveranstaltungen				
Titel		Тур	SWS	LP
Entwurf Integrierter Schaltungen (L	0691)	Vorlesung	3	4
Entwurf Integrierter Schaltungen (L	0998)	Gruppenübung	1	2
Modulverantwortlicher	Prof. Matthias Kuhl			
Zulassungsvoraussetzungen	None			
Empfohlene Vorkenntnisse	Basic knowledge of (solid-state) physics	and mathematics.		
	Knowledge in fundamentals of electrical	engineering and electrical networks.		
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die	Studierenden die folgenden Lernergebnisse ern	 reicht	
Lernergebnisse				
Fachkompetenz				
Wissen				
Wisself	 Students can explain basic 	concepts of electron transport in se	emiconductor devic	es (energy band
	generation/recombination, carrier	concentrations, drift and diffusion current dens	ities, semiconductor	device equations).
	 Students are able to explain funct 	ional principles of pn-diodes, MOS capacitors, a	nd MOSFETs using er	nergy band diagrams
	Students can present and discuss	current-voltage relationships and small-signal e	equivalent circuits of	these devices.
	 Students can explain the physics a 	and current-voltage behavior transistors based	on charged carrier flo	ow.
	 Students are able to explain the b 	asic concepts for static and dynamic logic gates	s for integrated circui	its
	 Students can exemplify approache 	es for low power consumption on the device and	d circuit level	
	Students can describe the potential	al and limitations of analytical expression for de	evice and circuit analy	ysis.
	Students can explain characteriza	tion techniques for MOS devices.		
Fertigkeiten				
reitigkeiteir	 Students can qualitatively constru 	ct energy band diagrams of the devices for vary	ying applied voltages	i.
	 Students are able to qualitativel 	ly determine electric field, carrier concentrat	ions, and charge flo	ow from energy bar
	diagrams.			
	Students can understand scientific	publications from the field of semiconductor d	evices.	
	Students can calculate the dimension	sions of MOS devices in dependence of the circu	uits properties	
	Students can design complex elec	tronic circuits and anticipate possible problems	j.	
	Students know procedure for optir	mization regarding high performance and low po	ower consumption	
Personale Kompetenzen				
Sozialkompetenz				
	Students can team up with other expressions	experts in the field to work out innovative soluti	ons.	
	-	own or in small groups for solving problems an	·	uestions.
	 Students have the ability to critical 	ally question the value of their contributions to v	working groups.	
Selbstständigkeit				
	Students are able to assess their k			
	 Students are able to define their p 	personal approaches to solve challenging proble	:ms	
	Eigenstudium 124, Präsenzstudium 56			
Leistungspunkte				
Studienleistung				
Prüfung				
Prüfungsdauer und -umfang				
	Elektrotechnik: Vertiefung Nanoelektroni	· ·		
Curricula		en: Vertiefung II. Elektrotechnik: Wahlpflicht		
	Mechanical Engineering and Managemer	•		
	Mechatronics: Vertiefung Systementwurf	: Wahlpflicht		
	Microelectronics and Microsystems: Kern	qualifikation: Wahlpflicht		

Lehrveranstaltung L0691: In	tegrated Circuit Design			
Тур	Vorlesung			
SWS				
LP				
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 78, Präsenzstudium 42			
Dozenten	Prof. Matthias Kuhl			
Sprachen	EN			
Zeitraum	WiSe			
Inhalt	 Electron transport in semiconductors Electronic operating principles of diodes, MOS capacitors, and MOS field-effect transistors MOS transistor as four terminal device Performace degradation due to short channel effects Scaling-down of MOS technology Digital logic circuits Basic analog circuits Operational amplifiers Bipolar and BiCMOS circuits 			
Literatur	 Yuan Taur, Tak H. Ning: Fundamentals of Modern VLSI Devices, Cambridge University Press 1998 R. Jacob Baker: CMOS, Circuit Design, Layout and Simulation, IEEE Press, Wiley Interscience, 3rd Edition, 2010 Neil H.E. Weste and David Money Harris, Integrated Circuit Design, Pearson, 4th International Edition, 2013 John E. Ayers, Digital Integrated Circuits: Analysis and Design, CRC Press, 2009 Richard C. Jaeger and Travis N. Blalock: Microelectronic Circuit Design, Mc Graw-Hill, 4rd. Edition, 2010 			

ehrveranstaltung L0998: Integrated Circuit Design			
Тур	Gruppenübung		
SWS	1		
LP	2		
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 46, Präsenzstudium 14		
Dozenten	Prof. Matthias Kuhl		
Sprachen	EN		
Zeitraum	WiSe		
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung		
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung		

Modul M0746: Microsy	ystem Engineerin	g				
Lehrveranstaltungen						
Titel				Тур	sws	LP
Mikrosystemtechnik (L0680)				Vorlesung	2	4
Mikrosystemtechnik (L0682)				Projekt-/problembasierte	2	2
				Lehrveranstaltung		
Modulverantwortlicher	Dr. Thomas Kusserow					
Zulassungsvoraussetzungen	None					
Empfohlene Vorkenntnisse	Basic courses in physics,	mathematics and elect	tric engineering			
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilna	hme haben die Studier	enden die folger	nden Lernergebnisse erreicht		
Lernergebnisse						
Fachkompetenz						
Wissen	The students know abou	it the most important	technologies an	d materials of MEMS as wel	l as their applic	cations in sensors and
	actuators.					
Fertigkeiten		halyze and describe th	ne functional be	haviour of MEMS componer	nts and to eva	luate the potential of
	microsystems.					
Personale Kompetenzen						
Sozialkompetenz	Students are able to solve specific problems alone or in a group and to present the results accordingly.					
Selbstständigkeit		uire particular knowled	ge using special	lized literature and to integra	ate and associat	te this knowledge with
	other fields.					
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 124, Präse	nzstudium 56				
Leistungspunkte	6					
Studienleistung	Verpflichtend Bonus Ar	t der Studienleistung	Beschreibung			
	Nein 10 % Re	eferat				
Prüfung	Klausur					
Prüfungsdauer und -umfang	zweistündig					
Zuordnung zu folgenden	Elektrotechnik: Kernquali	fikation: Pflicht				
Curricula	Internationales Wirtschaf	tsingenieurwesen: Vert	iefung II. Elektro	technik: Wahlpflicht		
	Internationales Wirtschaf	tsingenieurwesen: Vert	iefung II. Mecha	tronik: Wahlpflicht		
	Mechanical Engineering a	and Management: Verti	efung Mechatror	nik: Wahlpflicht		
	Mechatronics: Vertiefung	Systementwurf: Wahlp	oflicht			
	Microelectronics and Microsystems: Kernqualifikation: Wahlpflicht					
	Theoretischer Maschinen	bau: Vertiefung Bio- un	d Medizintechnil	k: Wahlpflicht		

Lehrveranstaltung L0680: Microsystem Engineering		
Тур	Vorlesung	
SWS	2	
LP	4	
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 92, Präsenzstudium 28	
Dozenten	Dr. Thomas Kusserow	
Sprachen		
Zeitraum		
Inhalt	Object and goal of MEMS	
	Scaling Rules	
	Lithography	
	Film deposition	
	Structuring and etching	
	Energy conversion and force generation	
	Electromagnetic Actuators	
	Reluctance motors	
	Piezoelectric actuators, bi-metal-actuator	
	Transducer principles	
	Signal detection and signal processing	
	Mechanical and physical sensors	
	Acceleration sensor, pressure sensor	
	Sensor arrays	
	System integration	
	Yield, test and reliability	
Literatur	M. Kasper: Mikrosystementwurf, Springer (2000)	
	M. Madou: Fundamentals of Microfabrication, CRC Press (1997)	

Lehrveranstaltung L0682: Microsystem Engineering		
Тур	Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung	
SWS	2	
LP	2	
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 32, Präsenzstudium 28	
Dozenten	Dr. Thomas Kusserow	
Sprachen	EN	
Zeitraum	WiSe	
Inhalt	Examples of MEMS components	
	Layout consideration	
	Electric, thermal and mechanical behaviour	
	Design aspects	
Literatur	Wird in der Veranstaltung bekannt gegeben	

Microsystems"						
Modul M0768: Micros	ystems Techno	ology in Theory ar	nd Practice			
.ehrveranstaltungen						
Titel Mikrosystemtechnologie (L0724) Mikrosystemtechnologie (L0725)			\ P	Typ /orlesung Projekt-/problembasierte	SWS 2 2	LP 4 2
Modulverantwortlicher	Prof Hoc Khiem Trie	11	L	Lehrveranstaltung		
Zulassungsvoraussetzungen		u				
Empfohlene Vorkenntnisse		emistry, mechanics and se	emiconductor techn	ology		
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher T	eilnahme haben die Studie	erenden die folgend	en Lernergebnisse erreich	nt	
Lernergebnisse Fachkompetenz						
•	Students are able					
	microsensors and mi to explain in det	I to explain current fabric icroactuators, as well as th ails operation principles o otential and limitation of n	he integration thereo	of in more complex system		for the fabrication
Fertigkeiten	,	e easibility of microsystems, ess flows for the fabricatio		s and		
Personale Kompetenzen Sozialkompetenz	Students are able to of audience.	prepare and perform thei	ir lab experiments ir	n team work as well as to	present and discu	iss the results in fro
Selbstständigkeit	None					
Arbeitsaufwand in Stunden		räsenzstudium 56				
Leistungspunkte	6 Verpflichtend Bonus	Art der Studienleistung	Beschreibung			
Studienleistung	Ja Keiner	Fachtheoretisch- fachpraktische Studienleistung	Studierenden	führen in Kleingruppen e d diskutiert die Theorie so nten Kurs.		
Prüfung	Mündliche Prüfung					
Prüfungsdauer und -umfang						
Zuordnung zu folgenden		3	,	k: Wahlpflicht		
Curricula	·					
		schaftsingenieurwesen: Ve sen: Vertiefung Implantate				
	_					
	Mediziningenieurwesen: Vertiefung Medizin- und Regelungstechnik: Wahlpflicht Mediziningenieurwesen: Vertiefung Management und Administration: Wahlpflicht					
	_	sen: Vertiefung Künstliche			ht	
	_	Microsystems: Kernqualif				

Lehrveranstaltung L0724: M	icrosystems Technology
-	Vorlesung
SWS	
LP	4
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 92, Präsenzstudium 28
Dozenten	Prof. Hoc Khiem Trieu
Sprachen	EN
Zeitraum	WiSe
Inhalt	
Literatur	
	N. Schwesinger: Lehrbuch Mikrosystemtechnik, Oldenbourg Verlag, 2009
	T. M. Adams, R. A. Layton:Introductory MEMS, Springer, 2010
	G. Gerlach; W. Dötzel: Introduction to microsystem technology, Wiley, 2008

Lehrveranstaltung L0725: Microsystems Technology		
Тур	Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung	
sws	2	
LP	2	
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 32, Präsenzstudium 28	
Dozenten	Prof. Hoc Khiem Trieu	
Sprachen	EN	
Zeitraum	WiSe	
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung	
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung	

Modul M1137: Technis	scher Ergänzungskurs für IMPMM - Bereich ET (laut FSPO)
Lehrveranstaltungen	
Titel	Typ SWS LP
Modulverantwortlicher	Prof. Hoc Khiem Trieu
Zulassungsvoraussetzungen	Keine
Empfohlene Vorkenntnisse	Grundlegende Kenntnisse in Elektrotechnik, Physik, Halbleiterbauelemente und Mathematik auf Bachelor-Niveau.
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studierenden die folgenden Lernergebnisse erreicht
Lernergebnisse	
Fachkompetenz	
Wissen	Da dieses Modul aus dem Modul-Katalog des Dekanats E frei gewählt werden kann, richtet sich die Fachkompetenz nach dem jeweils gewählten Fach.
Fertigkeiten	Da dieses Modul aus dem Modul-Katalog des Dekanats E frei gewählt werden kann, richten sich die zu erwerbenden Fertigkeiten nach dem jeweils gewählten Fach.
Personale Kompetenzen	
Sozialkompetenz	
	 Studierende können mit einem der mehreren Partnern mit unterschiedlichem fachlichen Hintergrund effektiv zusammenarbeiten. Studierende können selbständig alleine oder in einer kleinen Gruppe fachliche Probleme lösen und Fachfragen beantworten.
Selbstständigkeit	 Studierende sind in der Lage, ihr erworbenes Wissen realistisch einzuschätzen. Die Studierenden können Szenarien entwickeln, um die Auswirkungen von moderner, mobiler Elektronik auf der zukünftigen Lebensstil der Gesellschaft einzuschätzen.
Arbeitsaufwand in Stunden	Abhängig von der Wahl der Lehrveranstaltungen
Leistungspunkte	6
Zuordnung zu folgenden	Microelectronics and Microsystems: Kernqualifikation: Wahlpflicht
Curricula	

Modul M0918: Advanc	ced IC Design			
Lehrveranstaltungen				
Titel Erweiterter IC-Entwurf (L0766) Erweiterter IC-Entwurf (L1057)		Typ Vorlesung Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung	SWS 2 2	LP 3 3
Modulverantwortlicher	Prof. Matthias Kuhl	5		
Zulassungsvoraussetzungen	None			
Empfohlene Vorkenntnisse	Fundamentals of electrical engineering, electronic device	es and circuits		
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studierenden di	e folgenden Lernergebnisse erreicht		
Lernergebnisse				
Fachkompetenz				
	Students can explain the basic structure of the cir Students are able to describe the differences betw Students can discuss the different concept for rea Students can exemplify the approaches for "Desig Students can specify models for calculation of the	veen the MOS transistor models of the lization the hardware of electronic country in for Testability".		otor SPICE.
Fertigkeiten	 Students can determine the input parameters for Students can select the most appropriate MOS mo Students can quantify the trade-off of different de Students can determine the lot sizes and costs for 	delling approaches for circuit simula sign styles.		
Personale Kompetenzen Sozialkompetenz	 Students can compile design studies by themselve Students are able to select the most efficient desi Students are able to define the work packages for 	gn methodology for a given task.		
Selbstständigkeit	Students are able to assess the strengths and wea Students can name and bring together all the tool	•	elf-contained ma	anner.
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 124, Präsenzstudium 56			
Leistungspunkte	6			
Studienleistung	Keine			
Prüfung	Klausur			
Prüfungsdauer und -umfang	90 min			
	Elektrotechnik: Vertiefung Nanoelektronik und Mikrosyst Microelectronics and Microsystems: Kernqualifikation: W			

Lehrveranstaltung L0766: Ac	Ivanced IC Design
Тур	Vorlesung
SWS	2
LP	3
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28
Dozenten	Prof. Matthias Kuhl
Sprachen	EN
Zeitraum	SoSe
Inhalt	 Circuit-Simulator SPICE SPICE-Models for MOS transistors IC design Technology of MOS circuits Standard cell design Design of gate arrays CMOS transconductance and transimpedance amplifiers frequency behavior of CMOS circuits Techniques for improved circuit behaviour (e.g. cascodes, gain boosting, folding,) Examples for realization of ASICs in the institute of nanoelectronics Reliability of integrated circuits Testing of integrated circuits
Literatur	R. J. Baker, "CMOS-Circuit Design, Layout, and Simulation", Wiley & Sons, IEEE Press, 2010 B. Razavi, "Design of Analog CMOS Integrated Circuits", McGraw-Hill Education Ltd, 2000 X. Liu, VLSI-Design Methodology Demystified; IEEE, 2009

Lehrveranstaltung L1057: Advanced IC Design		
Тур	Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung	
sws	2	
LP	3	
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28	
Dozenten	Prof. Matthias Kuhl, Weitere Mitarbeiter	
Sprachen	EN	
Zeitraum	SoSe	
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung	
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung	

Microsystems				
Modul M0761: Halblei	itertechnologie			
Lehrveranstaltungen				
Titel		Тур	sws	LP
Halbleitertechnologie (L0722)		Vorlesung	4	4
Halbleitertechnologie (L0723)		Laborpraktikum	2	2
Modulverantwortlicher	Prof. Hoc Khiem Trieu			
Zulassungsvoraussetzungen	Keine			
Empfohlene Vorkenntnisse	Grundlagen in Physik, Chemie, Werkstoffen und Ha	Ibleiterbauelemente		
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studierend	len die folgenden Lernergebnisse erro	eicht	
Lernergebnisse				
Fachkompetenz				
Wissen				
	Die Studierenden können			
	die aktuellen Herstellungsmethoden für Si- und	GaAs- Substrate beschreiben und er	klären,	
	die wesentlichen Prozesse, ihre Abfolge und A	uswirkungen zur Herstellung von Hal	bleiterbauelementer	und hochintegriert
	Schaltungen erläutern und			
	integrierte Prozessabläufe darstellen.			
F. 1'. (. 1'				
Fertigkeiten				
	Studierende sind in der Lage,			
	eine Δnalyse der Finflüsse von Prozessnaramet	earn auf die Prozessierung durchzufüh	aron	
	eine Analyse der Einflüsse von Prozessparamet	ern auf die Prozessierung durchzulur	iren,	
	Prozesse auszuwählen und zu bewerten sowie			
	Prozessfolgen für die Herstellung von Halble	siterhauelementen zu entwerfen		
	1102c33loigen für die Herstellung von Habie	increduction and a chewerren.		
Personale Kompetenzen				
Sozialkompetenz				
Sozianompetenz				
	Studierende können in Gruppen Versuche planen, o	lurchführen sowie die Ergebnisse prä	sentieren und vor an	deren vertreten.
Selbstständigkeit	Keine			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 96, Präsenzstudium 84			
Leistungspunkte	6			
Studienleistung	Keine			
Prüfung	Mündliche Prüfung			
Prüfungsdauer und -umfang				
Zuordnung zu folgenden		osystemtechnik: Wahlpflicht		
Curricula	_	•	flicht	
	Mediziningenieurwesen: Vertiefung Implantate und	Endoprothesen: Wahlpflicht		
	Mediziningenieurwesen: Vertiefung Medizin- und Re	egelungstechnik: Wahlpflicht		
	Mediziningenieurwesen: Vertiefung Management ur	nd Administration: Wahlpflicht		
	Microelectronics and Microsystems: Kernqualifikation	on: Wahlpflicht		

Microsystems"	
Lehrveranstaltung L0722: Ha	albleitertechnologie
Тур	Vorlesung
SWS	4
LP	4
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 64, Präsenzstudium 56
Dozenten	Prof. Hoc Khiem Trieu
Sprachen	DE/EN
Zeitraum	SoSe
Inhalt	 Einführung (historische Betrachtung und Trends in der Mikroelektronik) Werkstoffgrundlagen (Halbleiter, Kristalle, Miller-Indizes, Kristalleher) Kristallherstellung (Kristallzucht für Si und GaAs: Verunreinigungen, Reinigung, Czochralski-, Bridgeman- und Zonenschmelz-Verfahren) Waferherstellung (Prozessabfolge, Parameter, SOI) Prozessgrundlagen Dotierung (Bändermodell, Dotierung, Dotierung durch Legieren, Dotierung durch Diffusion: Transportprozesse, Dotierungsprofile, Effekte höherer Ordnung und Prozesstechnik, Ionenimplantation: Theorie, Implantationsprofile, Channeling, Implantationsschäden, Ausheilprozesse und Anlagentechnik) Oxidation (Siliziumdioxid: Struktur, elektrische Eigenschaften und Ladungen im Oxid, thermische Oxidation: Reaktionen, Kinetik, Einfüsse auf Wachstumsrate und Prozess- und Anlagentechnik, anodische Oxidation, Plasmaoxidation, thermische Oxidation von GaAs) Abscheideverfahren (Theorie: Keimbildung, Schichtwachstum und Strukturzonenmodell, Wachstumsprozess, Reaktionskinetik, Temperatureinfluss und Reaktorbau; Epitaxie: Gasphasen-, Flüssigphasen-, Molekularstrahl-Epitaxie; CVD-Verfahren: APCVD, LPCVD, Abscheidung von Metallsiliziden, PECVD und LECVD; Grundlagen des Plasma, Anlagentechnik, PVD-Verfahren: Hochvakuum-Aufdampfen, Kathodenzerstäuben) Strukturierungsverfahren (subtraktive Verfahren, Photolithographie: Lackelgenschaften, Belichtungsverfahren, Kontakt-, Abstand- und Projektionsbelichtung, Auflösungsgrenze, Probleme in der Praxis und Belichtungseinrichtungen, additive Verfahren: Abhebetechnik und galvanische Abscheidung, Auflösungsverbesserung: Excimeriaser-Lichtquelle, Immersionsund Phasenkontrast-Lithographie, Elektronenstrahl-Lithographie, Röntgen-Lithographie, EUV-Lithographie, lonenstrahl-Lithographie, nasschemisches Ätzen: isotrop und anisotrop, Eckenunterätzung, Kompensationsmasken und Atzstoppverfahren: Trockenätzen: plasmaunterstütztes Ätzen, Rücksputtern,
Literatur	S.K. Ghandi: VLSI Fabrication principles - Silicon and Gallium Arsenide, John Wiley & Sons
	S.M. Sze: Semiconductor Devices - Physics and Technology, John Wiley & Sons
	U. Hilleringmann: Silizium-Halbleitertechnologie, Teubner Verlag
	H. Beneking: Halbleitertechnologie - Eine Einführung in die Prozeßtechnik von Silizium und III-V-Verbindungen, Teubner Verlag
	K. Schade: Mikroelektroniktechnologie, Verlag Technik Berlin
	S. Campbell: The Science and Engineering of Microelectronic Fabrication, Oxford University Press
	P. van Zant: Microchip Fabrication - A Practical Guide to Semiconductor Processing, McGraw-Hill

Lehrveranstaltung L0723: Halbleitertechnologie	
Тур	Laborpraktikum
SWS	2
LP	2
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 32, Präsenzstudium 28
Dozenten	Prof. Hoc Khiem Trieu
Sprachen	DE/EN
Zeitraum	SoSe
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung

Modul M0747: Micros	stem Design				
Lehrveranstaltungen					
Titel			Тур	sws	LP
Mikrosystementwurf (L0683)			Vorlesung	2	3
Mikrosystementwurf (L0684)			Laborpraktikum	3	3
Modulverantwortlicher	Dr. Thomas Kusserow	V			
Zulassungsvoraussetzungen	None				
Empfohlene Vorkenntnisse	Mathematical Calculu	us, Linear Algebra, Microsyst	em Engineering		
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Te	eilnahme haben die Studiere	nden die folgenden Lernergebnisse ei	rreicht	
Lernergebnisse					
Fachkompetenz					
Fertigkeiten Personale Kompetenzen Sozialkompetenz	The students know about the most important and most common simulation and design methods used in microsystem design. The scientific background of finite element methods and the basic theory of these methods are known. Students are able to apply simulation methods and commercial simulators in a goal oriented approach to complex design tasks. Students know to apply the theory in order achieve estimates of expected accuracy and can judge and verify the correctness of results. Students are able to develop a design approach even if only incomplete information about material data or constraints are available. Student can make use of approximate and reduced order models in a preliminary design stage or a system simulation. Students are able to solve specific problems alone or in a group and to present the results accordingly. Students can develop and explain their solution approach and subdivide the design task to subproblems which are solved separately by group members. Students are able to acquire particular knowledge using specialized literature and to integrate and associate this knowledge with				
	other fields.				
Arbeitsaufwand in Stunden		räsenzstudium 70			
Leistungspunkte					
Studienleistung	Verpflichtend Bonus Ja Keiner	Art der Studienleistung Schriftliche Ausarbeitung	Beschreibung		
Prüfung	Mündliche Prüfung				
Prüfungsdauer und -umfang	30 min				
Zuordnung zu folgenden	Elektrotechnik: Vertie	efung Nanoelektronik und Mi	krosystemtechnik: Wahlpflicht		
Curricula	Microelectronics and	Microsystems: Kernqualifika	tion: Wahlpflicht		

Lehrveranstaltung L0683: Microsystem Design				
Тур	Vorlesung			
SWS	2			
LP	3			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28			
Dozenten	Dr. Thomas Kusserow			
Sprachen	EN			
Zeitraum				
Inhalt	Finite difference methods			
	Approximation error			
	Finite element method			
	Order of convergence			
	Error estimation, mesh refinement			
	Makromodeling			
	educed order modeling			
	Black-box models			
	System identification			
	Multi-physics systems			
	System simulation			
	Levels of simulation, network simulation			
	Transient problems			
	Non-linear problems			
	Introduction to Comsol			
	Application to thermal, electric, electromagnetic, mechanical and fluidic problems			
Literatur	M. Kasper: Mikrosystementwurf, Springer (2000)			
	S. Senturia: Microsystem Design, Kluwer (2001)			

Lehrveranstaltung L0684: Microsystem Design				
Тур	Laborpraktikum			
SWS	3			
LP	3			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 48, Präsenzstudium 42			
Dozenten	Dr. Thomas Kusserow			
Sprachen	EN			
Zeitraum	SoSe			
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung			
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung			

Modul M1131: Technis	scher Ergänzungskurs für IMPMM - Bereich TUHH (laut FSPO)
Lehrveranstaltungen	
Titel	Typ SWS LP
Modulverantwortlicher	Prof. Hoc Khiem Trieu
Zulassungsvoraussetzungen	Keine
Empfohlene Vorkenntnisse	Grundlegende Kenntnisse in Elektrotechnik, Physik, Halbleiterbauelemente, Software und Mathematik auf Bachelor-Niveau.
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studierenden die folgenden Lernergebnisse erreicht
Lernergebnisse	
Fachkompetenz	
Wissen	Da dieses Modul aus dem Modul-Katalog der TUHH frei gewählt werden kann, richtet sich die Fachkompetenz nach dem jeweil: gewählten Fach.
Fertigkeiten	Da dieses Modul aus dem Modul-Katalog der TUHH frei gewählt werden kann, richten sich die zu erwerbenden Fertigkeiten nach dem jeweils gewählten Fach.
Personale Kompetenzen Sozialkompetenz	
	 Studierende können mit einem der mehreren Partnern mit unterschiedlichem fachlichen Hintergrund effektiv zusammenarbeiten. Studierende können selbständig alleine oder in einer kleinen Gruppe fachliche Probleme lösen und Fachfrager beantworten.
Selbstständigkeit	
Arbeitsaufwand in Stunden	Abhängig von der Wahl der Lehrveranstaltungen
Leistungspunkte	6
Zuordnung zu folgenden	Microelectronics and Microsystems: Kernqualifikation: Wahlpflicht
Curricula	

Modul M1130: Projekt	tarbeit IMPMM
Lehrveranstaltungen	
Titel	Typ SWS LP
Modulverantwortlicher	Dozenten des SD E
Zulassungsvoraussetzungen	Keine
Empfohlene Vorkenntnisse	Gute Kenntnisse in dem Design elektronischer Schaltkreise, im Aufbau von Mikroprozessorsystemen und für Signalverarbeitung
	sowie in der Handhabung von Softwarepaketen zur Simulation von elektrischen und physkalischen Vorgängen.
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studierenden die folgenden Lernergebnisse erreicht
Lernergebnisse	
Fachkompetenz	
Wissen	Die Studentin oder der Student kann sich in einem wissenschaftliches Teilgebiet selbständig vertiefte Kenntnisse erarbeiten und
	in diesem Teilgebiet selbständig Lösungswege für wissenschaftliche Fragestellungen benennen.
Fertigkeiten	Die Studentin oder der Student ist in der Lage, wissenschafltiche Problemstellungen zu beschreiben und die selbständig
	erarbeiteten Lösungswege in einer gut struktierten Form umzusetzen.
Personale Kompetenzen	
Sozialkompetenz	Die Studentin oder der Student kann sich in kleine Teams von Wissenschaftlern integrieren und die von ihr oder ihm erarbeiteten
	Lösungsvorschläge im Team diskutieren. Sie oder er ist in der Lage, ihre oder seine Ergebnisse in klarer und gut strukturierter
	Form zu präsentieren.
Selbstständigkeit	Die Studentin oder der Student kann wissenschaftliche Arbeiten zeitgerecht durchführen und die Ergebnisse in ausführlicher und
	verständlicher Form dokumentieren. Sie oder er ist in der Lage, mögliche Probleme rechtzeitig zu erkennen und
	Lösungsvorschläge zu erarbeiten.
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 450, Präsenzstudium 0
Leistungspunkte	15
Studienleistung	Keine
Prüfung	Studienarbeit
Prüfungsdauer und -umfang	laut FSPO
Zuordnung zu folgenden	Microelectronics and Microsystems: Kernqualifikation: Pflicht
Curricula	

Modul M1591: Semina	ar for IMPMM			
Lehrveranstaltungen				
Titel		Тур	sws	LP
Seminar für IMPMM (L2428)		Seminar	2	3
Modulverantwortlicher	Prof. Hoc Khiem Trieu			
Zulassungsvoraussetzungen	None			
Empfohlene Vorkenntnisse	Basics from the field of the seminar			
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die	Studierenden die folgenden Lernergebnisse er	rreicht	
Lernergebnisse				
Fachkompetenz				
Wissen	Students can explain the most important	t facts and relationships of a specific topic fron	n the field of the semir	nar.
Fertigkeiten	Students are able to compile a specified	d topic from the field of the seminar and to g	jive a clear, structured	d and comprehensible
	presentation of the subject. They can o	comply with a given duration of the presenta	ition. They can write i	in English a summary
	including illustrations that contains the n	nost important results, relationships and expla	nations of the subject.	
Personale Kompetenzen				
Sozialkompetenz	Students are able to adapt their present	ation with respect to content, detailedness, ar	nd presentation style to	o the composition and
	previous knowledge of the audience. They can answer questions from the audience in a curt and precise manner.			
Selbstständigkeit	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	y out a literature research concerning a given	. , , ,	endently evaluate the
	, ,	which parts of the material should be included	in the presentation.	
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28			
Leistungspunkte	3			
Studienleistung	Keine			
Prüfung	Referat			
Prüfungsdauer und -umfang	15 Minuten Vortrag + 5-10 Minuten Disk	ussion + 2 Seiten schriftliche Zusammenfassu	ng	
Zuordnung zu folgenden	Microelectronics and Microsystems: Kern	qualifikation: Pflicht	•	•
Curricula				

Lehrveranstaltung L2428: Se	eminar for IMPMM
Тур	Seminar
sws	2
LP	3
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28
Dozenten	Prof. Hoc Khiem Trieu
Sprachen	EN
Zeitraum	WiSe/SoSe
Inhalt	Prepare, present, and discuss talks about recent topics from the field of semiconductors. The presentations must be given in English.
	• understanding of subject, discussion, response to questions • structure and logic of presentation (clarity, precision) • coverage of the topic, selection of subjects presented • linguistic presentation (clarity, comprehensibility) • visual presentation (clarity, comprehensibility) • handout (see below) • compliance with timing requirement. Handout: A printed handout (short abstract) of your presentation in English language is mandatory. This should not be longer than two pages A4, and include the most important results, conclusions, explanations and diagrams.
Literatur	Aktuelle Veröffentlichungen zu dem gewählten Thema. Recent publications of the selected topics.

Fachmodule der Vertiefung Communication and Signal Processing

In der Vertiefungsrichtung Communication and Signal Processing erlernen die Studierenden sowohl die physikalischen und technischen Grundlagen moderner drahtgebundener und drahtloser Kommunikationssysteme als auch die Realisierung von technischen Ausführungsformen. Sie haben die Möglichkeit, ihre Kenntnisse in Richtung verschiedener Schwerpunkte, wie zum Beispiel Systeme für Audio- oder Videosignalprozessierung, auszubauen. Die Studierenden verstehen die Grundkonzepte dieser Systeme und können deren Grenzen erkennen. Mit Hilfe dieses Wissens können sie Verbesserungspotenzial identifizieren und Vorschläge für deren konkrete Umsetzung erarbeiten.

Alle Studierende müssen aus dieser Vertiefungsrichtung Lehrveranstaltungen mit einem Umfang von insgesamt 18 Leistungspunkten belegen.

Modul M0710: Hochfro	equenztechnik			
Lehrveranstaltungen				
Titel Hochfrequenztechnik (L0573)		Typ Vorlesung	sws 2	LP 3
Hochfrequenztechnik (L0574) Hochfrequenztechnik (L0575)		Hörsaalübung Laborpraktikum	2 1	2 1
Modulverantwortlicher	Prof. Alexander Kölpin			
Zulassungsvoraussetzungen	Keine			
Empfohlene Vorkenntnisse	Grundlagen der Nachrichtentechnik, Hal aus den Vorlesungen Leitungstheorie un	bleiterelektronik und elektronischer Schalt d Theoretische Elektrotechnik.	ungen, Grundkenntnisse (der Wellenausbreitung
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die	Studierenden die folgenden Lernergebniss	e erreicht	
Lernergebnisse				
Fachkompetenz				
Wissen	Die Studierenden können Phänomene bei der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in unterschiedlichen Frequenzbändern erklären. Sie können Übertragungssysteme und die darin enthaltenen Komponenten beschreiben. Sie können einen Überblick über unterschiedliche Antennentypen geben und die grundlegenden Kenngrößen von Antennen beschreiben. Sie können das Rauschen von linearen Schaltungen erklären, Schaltungsvarianten anhand von Kenngrößen vergleichen und für unterschiedliche Situationen die jeweils am besten geeignete wählen.			
Fertigkeiten	Die Studierenden sind in der Lage, die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen zu berechnen. Sie können komplette Übertragungssysteme analysieren und einfache Empfängerschaltungen auslegen. Sie können die Eigenschaften und Kenngrößen von einfachen Antennen und Gruppenstrahlern anhand aus der Geometrie berechnen. Sie können das Rauschen von Empfängern und den Signal-zu-Rausch-Abstand von kompletten Übertragungssystemen berechnen. Die Studienenden können die erlerne Theorie in Praktikumsversuchen anwenden.			
Personale Kompetenzen Sozialkompetenz	Die Studierenden führen während des F Ergebnisse gemeinsam.	raktikums in Gruppen versuche durch. Sie	e dokumentieren, diskutie	ren und bewerten die
Selbstständigkeit	Die Studierenden sind fähig das erlernte Wissen mit ihren Vorkenntnissen aus anderen Vorlesungen zu verknüpfen. Sie können unter Anleitung für die Lösung spezifischer Probleme notwendige Daten aus externen Quellen, wie Normen oder Literatur, extrahieren und anwenden. Sie sind in der Lage eigenständig und mit Hilfe der Praktikumsumdrucke ihr Wissen in die Praxis umzusetzen.			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 110, Präsenzstudium 70			
Leistungspunkte				
Studienleistung	Verpflichtend Bonus Art der Studienleistu	ing Beschreibung		
	Ja Keiner Fachtheoretisch- fachpraktische Studienleistung			
Prüfung				
Prüfungsdauer und -umfang				
Zuordnung zu folgenden	Elektrotechnik: Kernqualifikation: Pflicht Information and Communication System Internationales Wirtschaftsingenieurwes	s: Vertiefung Kommunikationssysteme: Wa en: Vertiefung II. Elektrotechnik: Wahlpflich iefung Communication and Signal Processi	nt	

Lehrveranstaltung L0573: Ho	ochfrequenztechnik
Тур	Vorlesung
SWS	2
LP	3
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28
	Prof. Alexander Kölpin
Sprachen	DE/EN
Zeitraum	WiSe
Inhalt	- Antennen: Berechnungsgrundlagen - Kenngrößen - Verschiedene Antennenformen
	- Funkwellenausbreitung
	- Sender: Leistungserzeugung mit Röhren - Sendeverstärker
	- Empfänger: Vorverstärker - Überlagerungsempfang - Empfangsempfindlichkeit - Rauschen
	- Ausgewählte Systembeispiele
Literatur	HG. Unger, "Elektromagnetische Theorie für die Hochfrequenztechnik, Teil I", Hüthig, Heidelberg, 1988
	HG. Unger, "Hochfrequenztechnik in Funk und Radar", Teubner, Stuttgart, 1994
	E. Voges, "Hochfrequenztechnik - Teil II: Leistungsröhren, Antennen und Funkübertragung, Funk- und Radartechnik", Hüthig, Heidelberg, 1991
	E. Voges, "Hochfrequenztechnik", Hüthig, Bonn, 2004
	C.A. Balanis, "Antenna Theory", John Wiley and Sons, 1982
	R. E. Collin, "Foundations for Microwave Engineering", McGraw-Hill, 1992
	D. M. Pozar, "Microwave and RF Design of Wireless Systems", John Wiley and Sons, 2001
	D. M. Pozar, "Microwave Engineerin", John Wiley and Sons, 2005

ehrveranstaltung L0574: Hochfrequenztechnik				
Тур	Hörsaalübung			
sws	2			
LP	2			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 32, Präsenzstudium 28			
Dozenten	Prof. Alexander Kölpin			
Sprachen	DE/EN			
Zeitraum	WiSe			
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung			
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung			

Lehrveranstaltung L0575: Hochfrequenztechnik				
Тур	Laborpraktikum			
sws	1			
LP	1			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 16, Präsenzstudium 14			
Dozenten	Prof. Alexander Kölpin			
Sprachen	DE/EN			
Zeitraum	WiSe			
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung			
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung			

Microsystems				
Modul M0836: Commu	unication Networks			
Lehrveranstaltungen				
Titel		Тур	sws	LP
Ausgewählte Themen der Kommunikationsnetze (L0899)		Projekt-/problembasierte	2	2
3		Lehrveranstaltung		
Kommunikationsnetze (L0897)		Vorlesung	2	2
Übung Kommunikationsnetze (L089	8)	Projekt-/problembasierte	1	2
		Lehrveranstaltung		
Modulverantwortlicher	Prof. Andreas Timm-Giel			
Zulassungsvoraussetzungen	None			
Empfohlene Vorkenntnisse	a. Francisco de la contra del contra de la contra del la contra de la contra del la cont			
	Fundamental stochastics Pasis understanding of computer natives	de and/or communication tachnologies is bon	oficial	
	Basic understanding of computer network	ks and/or communication technologies is ben	eliciai	
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studie	renden die folgenden Lernergebnisse erreicht		
Lernergebnisse				
Fachkompetenz				
Wissen	Students are able to describe the principles	and structures of communication networks in	n detail. They ca	an explain the formal
	description methods of communication netw	orks and their protocols. They are able to	explain how	current and complex
	communication networks work and describe th	e current research in these examples.		
Fertigkeiten	Students are able to evaluate the performance	•		*
	problems themselves and apply the learned methods. They can apply what they have learned autonomously on further			
	communication networks.			
Personale Kompetenzen				
•	Students are able to define tasks themselves i	n small teams and solve these problems toge	ther using the le	earned methods. They
, , , , , ,	can present the obtained results. They are able	·	-	,
		, ,		
Selbstständigkeit	Students are able to obtain the necessary exp	pert knowledge for understanding the function	nality and perfo	rmance capabilities of
	new communication networks independently.			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 110, Präsenzstudium 70			
Leistungspunkte	6			
Studienleistung	Keine			
Prüfung	Referat			
Prüfungsdauer und -umfang	1,5 Stunden Kolloquium mit je drei Prüfling	gen, also ca. 30 min je Prüfling. Inhalt d	es Kolloquiums	sind die Poster der
	vorhergehenden Postersession sowie die Lehrii	nhalte.		
Zuordnung zu folgenden	Elektrotechnik: Vertiefung Nachrichten- und Ko	mmunikationstechnik: Wahlpflicht		
Curricula	Elektrotechnik: Vertiefung Regelungs- und Ene	rgiesystemtechnik: Wahlpflicht		
	Flugzeug-Systemtechnik: Kernqualifikation: Wa	hlpflicht		
	Informatik-Ingenieurwesen: Vertiefung I. Inform	natik: Wahlpflicht		
	Information and Communication Systems: Vert	iefung Sichere und zuverlässige IT-Systeme, S	chwerpunkt Net	ze: Wahlpflicht
	Information and Communication Systems: Vert	iefung Kommunikationssysteme: Wahlpflicht		
	Internationales Wirtschaftsingenieurwesen: Ve	rtiefung II. Informationstechnologie: Wahlpflich	nt	
	Mechatronics: Technischer Ergänzungskurs: Wa	ahlpflicht		
	Microelectronics and Microsystems: Vertiefung	Communication and Signal Processing: Wahlp	flicht	

Lehrveranstaltung L0899: Se	Lehrveranstaltung L0899: Selected Topics of Communication Networks			
Тур	Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung			
SWS	2			
LP	2			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 32, Präsenzstudium 28			
Dozenten	Prof. Andreas Timm-Giel			
Sprachen	EN			
Zeitraum	WiSe			
Inhalt	Example networks selected by the students will be researched on in a PBL course by the students in groups and will be presented			
	in a poster session at the end of the term.			
Literatur	• see lecture			

Lehrveranstaltung L0897: Co	ommunication Networks
Тур	Vorlesung
SWS	2
LP	2
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 32, Präsenzstudium 28
Dozenten	Prof. Andreas Timm-Giel, Dr. Koojana Kuladinithi
Sprachen	EN
Zeitraum	WiSe
Inhalt	
Literatur	Skript des Instituts für Kommunikationsnetze Tannenbaum, Computernetzwerke, Pearson-Studium Further literature is announced at the beginning of the lecture.

Lehrveranstaltung L0898: Communication Networks Excercise				
Тур	Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung			
sws	1			
LP	2			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 46, Präsenzstudium 14			
Dozenten	Prof. Andreas Timm-Giel			
Sprachen	EN			
Zeitraum	WiSe			
Inhalt	Part of the content of the lecture Communication Networks are reflected in computing tasks in groups, others are motivated and			
	addressed in the form of a PBL exercise.			
Literatur	announced during lecture			

Modul M1700: Satellit	e Communications and I	lavigation		
Lehrveranstaltungen				
Titel		Тур	sws	LP
Funkbasierte Positionierung und Na	vigation (L2711)	Vorlesung	2	3
Satellitenkommunikation (L2710)		Vorlesung	2	3
Modulverantwortlicher	Prof. Gerhard Bauch			
Zulassungsvoraussetzungen	None			
Empfohlene Vorkenntnisse				
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme habe	n die Studierenden die folgenden Lernergebnisse er	reicht	
Lernergebnisse				
Fachkompetenz				
Wissen				
Fertigkeiten				
Personale Kompetenzen				
Sozialkompetenz				
Selbstständigkeit				
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 124, Präsenzstudium	56		
Leistungspunkte	6			
Studienleistung	Keine			
Prüfung	Mündliche Prüfung			
Prüfungsdauer und -umfang	30 min			
Zuordnung zu folgenden	Elektrotechnik: Vertiefung Nachrich	ten- und Kommunikationstechnik: Wahlpflicht		
Curricula	Information and Communication Sy	stems: Vertiefung Kommunikationssysteme, Schwer	punkt Signalverarbei	tung: Wahlpflicht
	Information and Communication	Systems: Vertiefung Sichere und zuverlässige	IT-Systeme, Schwei	rpunkt Software und
	Signalverarbeitung : Wahlpflicht			
	Microelectronics and Microsystems	Vertiefung Communication and Signal Processing:	Wahlpflicht	

Lehrveranstaltung L2711: Ra	Lehrveranstaltung L2711: Radio-Based Positioning and Navigation			
Тур	Vorlesung			
SWS	2			
LP	3			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28			
Dozenten	Prof. Gerhard Bauch, Dr. Rico Mendrzik			
Sprachen	EN			
Zeitraum	SoSe			
Inhalt				
Literatur				

Lehrveranstaltung L2710: Satellite Communications		
Тур	Vorlesung	
sws	2	
LP	3	
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28	
Dozenten	Prof. Gerhard Bauch	
Sprachen	EN	
Zeitraum	SoSe	
Inhalt		
Literatur		

Modul M1743: COSIM	A (Competition in Microsys	tem Application)		
Lehrveranstaltungen				
Titel		Тур	sws	LP
COSIMA (Competition in Microsyste	m Application) (L3094)	Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung	5	6
Modulverantwortlicher	Prof. Hoc Khiem Trieu			
Zulassungsvoraussetzungen	None			
Empfohlene Vorkenntnisse				
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben d	ie Studierenden die folgenden Lernergebnisse erreic	ht	
Lernergebnisse				
Fachkompetenz				
Wissen				
Fertigkeiten				
Personale Kompetenzen				
Sozialkompetenz				
Selbstständigkeit				
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 110, Präsenzstudium 70			
Leistungspunkte	6			
Studienleistung	Keine			
Prüfung	Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit			
Prüfungsdauer und -umfang	60 Minuten			
Zuordnung zu folgenden	Microelectronics and Microsystems: Ve	ertiefung Microelectronics Complements: Wahlpflicht		
Curricula	Microelectronics and Microsystems: Ve	ertiefung Microelectronics Complements: Wahlpflicht		
	Microelectronics and Microsystems: Ve	ertiefung Communication and Signal Processing: Wal	nlpflicht	
		ertiefung Communication and Signal Processing: Wal	nlpflicht	
	,	ertiefung Embedded Systems: Wahlpflicht		
	Microelectronics and Microsystems: Ve	ertiefung Embedded Systems: Wahlpflicht		

Lehrveranstaltung L3094: CC	Lehrveranstaltung L3094: COSIMA (Competition in Microsystem Application)		
Тур	Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung		
SWS			
LP	6		
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 110, Präsenzstudium 70		
Dozenten	Prof. Hoc Khiem Trieu, Dozenten des Studiengangs		
Sprachen	EN		
Zeitraum	WiSe/SoSe		
Inhalt			
Literatur			

	ced Concepts of Wireless Communica			
Lehrveranstaltungen				
Titel		Тур	sws	LP
Weiterführende Konzepte der draht		Vorlesung	3	4
Weiterführende Konzepte der draht		Hörsaalübung	2	2
Modulverantwortlicher	Dr. Rainer Grünheid			
Zulassungsvoraussetzungen	None			
Empfohlene Vorkenntnisse	Lecture "Signals and Systems"			
	Lecture "Fundamentals of Telecommunication."	s and Stochastic Processes"		
	Lecture "Digital Communications"	s una stochastic i rocesses		
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studierende	n die folgenden Lernergebnisse erre	eicht	
Lernergebnisse				
Fachkompetenz				
Wissen	Students are able to explain the general as we	ell as advanced principles and t	echniques that are	applied to wireles
	communications. They understand the properties	of wireless channels and the	corresponding math	ematical description
	Furthermore, students are able to explain the physic	al layer of wireless transmission sys	tems. In this context	, they are proficient i
	the concepts of multicarrier transmission (OFDM)	, modulation, error control coding	g, channel estimatio	n and multi-antenn
	techniques (MIMO). Students can also explain met	thods of multiple access. On the e	example of contemp	orary communicatio
	systems (UMTS, LTE) they can put the learnt content	into a larger context.		
Fertigkeiten	Using the acquired knowledge, students are able to u	understand the design of current an	d future wireless syst	tems. Moreover, give
	certain constraints, they can choose appropriate par	rameter settings of communication	systems. Students a	re also able to asses
	the suitability of technical concepts for a given applic	cation.		
Personale Kompetenzen				
Sozialkompetenz	Students can jointly elaborate tasks in small groups a	and present their results in an adeq	uate fashion.	
Selbstständigkeit	Students are able to extract necessary information	from given literature sources and	put it into the persp	ective of the lecture
	They can continuously check their level of experti	se with the help of accompanying	g measures (such as	s online tests, clicke
	questions, exercise tasks) and, based on that, to	steer their learning process acc	ordingly. They can	relate their acquire
	knowledge to topics of other lectures, e.g., "Fu	undamentals of Communications	and Stochastic Pro	cesses" and "Digita
	Communications".			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 110, Präsenzstudium 70			
Leistungspunkte	6			
Studienleistung	Keine			
Prüfung	Klausur			
Prüfungsdauer und -umfang	90 Minuten; Umfang: Inhalt von Vorlesung und Übun	g		
Zuordnung zu folgenden	Elektrotechnik: Vertiefung Nachrichten- und Kommur	nikationstechnik: Wahlpflicht		
Curricula	Information and Communication Systems: Vertiefung	Kommunikationssysteme: Wahlpfli	cht	
	Microelectronics and Microsystems: Vertiefung Comm	nunication and Signal Processing: W	/ahlpflicht	

Lehrveranstaltung L0297: Ac	dvanced Concepts of Wireless Communications
Тур	Vorlesung
SWS	3
LP	4
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 78, Präsenzstudium 42
Dozenten	Dr. Rainer Grünheid
Sprachen	EN
Zeitraum	SoSe
Inhalt	The lecture deals with technical principles and related concepts of mobile communications. In this context, the main focus is put on the physical and data link layer of the ISO-OSI stack.
	In the lecture, the transmission medium, i.e., the mobile radio channel, serves as the starting point of all considerations. The characteristics and the mathematical descriptions of the radio channel are discussed in detail. Subsequently, various physical layer aspects of wireless transmission are covered, such as channel coding, modulation/demodulation, channel estimation, synchronization, and equalization. Moreover, the different uses of multiple antennas at the transmitter and receiver, known as MIMO techniques, are described. Besides these physical layer topics, concepts of multiple access schemes in a cellular network are outlined. In order to illustrate the above-mentioned technical solutions, the lecture will also provide a system view, highlighting the basics of some contemporary wireless systems, including UMTS/HSPA, LTE, LTE Advanced, and WiMAX.
Literatur	John G. Proakis, Masoud Salehi: Digital Communications. 5th Edition, Irwin/McGraw Hill, 2007 David Tse, Pramod Viswanath: Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge, 2005 Bernard Sklar: Digital Communications: Fundamentals and Applications. 2nd Edition, Pearson, 2013 Stefani Sesia, Issam Toufik, Matthew Baker: LTE - The UMTS Long Term Evolution. Second Edition, Wiley, 2011

ehrveranstaltung L0298: Advanced Concepts of Wireless Communications			
Тур	Hörsaalübung		
sws	2		
LP	2		
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 32, Präsenzstudium 28		
Dozenten	Dr. Rainer Grünheid		
Sprachen	EN		
Zeitraum	SoSe		
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung		
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung		

Modul M1686: Selecte	d Aspects of Communication and	Signal Processing		
Lehrveranstaltungen				
Titel		Тур	sws	LP
Ausgewählte Aspekte der Kommuni	kation und Signalverarbeitung (L2674)	Vorlesung	3	4
Ausgewählte Aspekte der Kommuni	kation und Signalverarbeitung (L2675)	Gruppenübung	1	2
Modulverantwortlicher	Prof. Hoc Khiem Trieu			
Zulassungsvoraussetzungen	None			
Empfohlene Vorkenntnisse				
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studiere	nden die folgenden Lernergebnisse erre	eicht	
Lernergebnisse				
Fachkompetenz				
Wissen				
Fertigkeiten				
Personale Kompetenzen				
Sozialkompetenz				
Selbstständigkeit				
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 124, Präsenzstudium 56			
Leistungspunkte	6			
Studienleistung	Keine			
Prüfung	Mündliche Prüfung			
Prüfungsdauer und -umfang	30 min			
Zuordnung zu folgenden	Microelectronics and Microsystems: Vertiefung Co	ommunication and Signal Processing: W	ahlpflicht	
Curricula			•	

Lehrveranstaltung L2674: Selected Aspects of Communication and Signal Processing				
Тур	Vorlesung			
sws	3			
LP	4			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 78, Präsenzstudium 42			
Dozenten	Dozenten des SD E			
Sprachen	EN			
Zeitraum	WiSe/SoSe			
Inhalt				
Literatur				

Lehrveranstaltung L2675: Selected Aspects of Communication and Signal Processing			
Тур	Gruppenübung		
sws	1		
LP	2		
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 46, Präsenzstudium 14		
Dozenten	Dozenten des SD E		
Sprachen	EN		
Zeitraum	WiSe/SoSe		
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung		
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung		

Modul M1598: Bildvor	zarboitung				
Modul M1598: Bildver	arbeitung				
Lehrveranstaltungen					
Titel		Тур	sws	LP	
Bildverarbeitung (L2443)		Vorlesung	2	4	
Bildverarbeitung (L2444)		Gruppenübung	2	2	
Modulverantwortlicher	Prof. Tobias Knopp				
Zulassungsvoraussetzungen	Keine				
Empfohlene Vorkenntnisse	Signal und Systeme				
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studierender	n die folgenden Lernergebnisse erre	eicht		
Lernergebnisse					
Fachkompetenz					
Wissen	Die Studierenden kennen				
	Visuelle Wahrnehmung				
	Mehrdimensionale Signalverarbeitung				
	Abtastung und Abtasttheorem				
	Filterung				
	Bildverbesserung				
	Kantendetektion				
	Mehrfachauflösende Verfahren: Gauss- und La	place-Pyramide, Wavelets			
	Bildkompression				
	Segmentierung				
	 Morphologische Bildverarbeitung 				
Fertigkeiten	Die Studierenden können				
	multidimensionale Bilddaten analysieren, bear	haitan varhassarn			
	einfache Kompressionsalgorithmen implement				
	eigene Filter für konkrete Anwendungen entwe				
Personale Kompetenzen					
Sozialkompetenz	Die Studierenden können in sowohl selbstständig als auch in Teams an komplexen Problemen arbeiten. Sie können sie untereinander austauschen und ihre individuellen Stärken zur Lösung des Problems einbringen.				
	unteremander austauschen und ihre individuellen sta	irken zur Losung des Problems einb	ringen.		
Selbstständigkeit	Die Studierenden sind in der Lage ein komplexes Pro	bblem eigenständig zu untersuchen	und einzuschätzen,	welche Kompetenz	
	zur Lösung des Problems benötigt werden.				
Arheitszufwand in Stunden	Eigenstudium 124, Präsenzstudium 56				
Leistungspunkte					
Studienleistung Prüfung					
Prüfungsdauer und -umfang					
	Data Science: Kernqualifikation: Wahlpflicht	ablaficht			
Curricula	Data Science: Vertiefung I. Mathematik/Informatik: Wahlpflicht Elektrotechnik: Vertiefung Nachrichten- und Kommunikationstechnik: Wahlpflicht				
	Elektrotechnik: Vertiefung Medizintechnik: Wahlpflich				
	Information and Communication Systems: Vertiefung Sichere und zuverlässige IT-Systeme, Schwerpunkt Software un				
	Signalverarbeitung : Wahlpflicht				
	Information and Communication Systems: Vertiefung Kommunikationssysteme, Schwerpunkt Signalverarbeitung: Wahlpflicht				
ĺ					
	Internationales Wirtschaftsingenieurwesen: Vertiefun				
	Internationales Wirtschaftsingenieurwesen: Vertiefun Mechatronics: Vertiefung Intelligente Systeme und Ro				
	_	obotik: Wahlpflicht	,		
	Mechatronics: Vertiefung Intelligente Systeme und Ro	bbotik: Wahlpflicht			

Lehrveranstaltung L2443: Bi	ldverarbeitung
Тур	Vorlesung
SWS	2
LP	4
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 92, Präsenzstudium 28
Dozenten	Prof. Tobias Knopp
Sprachen	DE/EN
Zeitraum	WiSe
Inhalt	 Visuelle Wahrnehmung Mehrdimensionale Signalverarbeitung Abtastung und Abtasttheorem Filterung Bildverbesserung Kantendetektion Mehrfachauflösende Verfahren: Gauss- und Laplace-Pyramide, Wavelets Bildkompression Segmentierung Morphologische Bildverarbeitung
Literatur	Bredies/Lorenz, Mathematische Bildverarbeitung, Vieweg, 2011 Pratt, Digital Image Processing, Wiley, 2001 Bernd Jähne: Digitale Bildverarbeitung - Springer, Berlin 2005

Lehrveranstaltung L2444: Bildverarbeitung		
Тур	Gruppenübung	
sws	2	
LP	2	
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 32, Präsenzstudium 28	
Dozenten	Prof. Tobias Knopp	
Sprachen	DE/EN	
Zeitraum	WiSe	
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung	
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung	

Modul M0738: Digital	Audio Signal Processing			
Lehrveranstaltungen				
Titel		Тур	sws	LP
Digitale Audiosignalverarbeitung (L0	0650)	Vorlesung	3	4
Digitale Audiosignalverarbeitung (LC)651)	Hörsaalübung	1	2
Modulverantwortlicher	Prof. Udo Zölzer			
Zulassungsvoraussetzungen	None			
Empfohlene Vorkenntnisse	Signals and Systems			
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studierenden o	lie folgenden Lernergebnisse er	reicht	
Lernergebnisse				
Fachkompetenz				
	Die Studierenden können die grundlegenden Verfahren und Methoden der digitalen Audiosignalverarbeitung erklären. Sie könner die wesentlichen physikalischen Effekte bei der Sprach- und Audiosignalverarbeitung erläutern und in Kategorien einordnen. Sie können einen Überblick der numerischen Methoden und messtechnischen Charakterisierung von Algorithmen zur Audiosignalverarbeitung geben. Sie können die erarbeiteten Algorithmen auf weitere Anwendungen im Bereich der Informationstechnik und Informatik abstrahieren.			
Fertigkeiten	The students will be able to apply methods and techniques from audio signal processing in the fields of mobile and internet communication. They can rely on elementary algorithms of audio signal processing in form of Matlab code and interactive JAVA applets. They can study parameter modifications and evaluate the influence on human perception and technical applications in a variety of applications beyond audio signal processing. Students can perform measurements in time and frequency domain in order to give objective and subjective quality measures with respect to the methods and applications.			
Personale Kompetenzen				
Sozialkompetenz	The students can work in small groups to study spec adequate methods during the exercise.	ial tasks and problems and wi	ll be enforced to pres	ent their results with
Selbstständigkeit	The students will be able to retrieve information out of the relevant literature in the field and putt hem into the context of the lecture. They can relate their gathered knowledge and relate them to other lectures (signals and systems, digital communication systems, image and video processing, and pattern recognition). They will be prepared to understand and communicate problems and effects in the field audio signal processing.			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 124, Präsenzstudium 56			
Leistungspunkte	6			
Studienleistung	Keine			
Prüfung	Klausur			
Prüfungsdauer und -umfang	60 min			
Zuordnung zu folgenden	Elektrotechnik: Vertiefung Nachrichten- und Kommunika	ationstechnik: Wahlpflicht		
Curricula	Information and Communication Systems: Vertiefung Ko Information and Communication Systems: Vertiefur Signalverarbeitung: Wahlpflicht Microelectronics and Microsystems: Vertiefung Commun	ng Sichere und zuverlässige	IT-Systeme, Schwerp	

Lehrveranstaltung L0650: Di	gital Audio Signal Processing			
Тур	Vorlesung			
sws	3			
LP	4			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 78, Präsenzstudium 42			
Dozenten	Prof. Udo Zölzer			
Sprachen	EN			
Zeitraum	WiSe			
Inhalt	 Introduction (Studio Technology, Digital Transmission Systems, Storage Media, Audio Components at Home) Quantization (Signal Quantization, Dither, Noise Shaping, Number Representation) 			
	AD/DA Conversion (Methods, AD Converters, DA Converters, Audio Processing Systems, Digital Signal Processors, Digital Audio Interfaces, Single-Processor Systems, Multiprocessor Systems)			
	Equalizers (Recursive Audio Filters, Nonrecursive Audio Filters, Multi-Complementary Filter Bank)			
	Room Simulation (Early Reflections, Subsequent Reverberation, Approximation of Room Impulse Responses)			
	Dynamic Range Control (Static Curve, Dynamic Behavior, Implementation, Realization Aspects)			
	Sampling Rate Conversion (Synchronous Conversion, Asynchronous Conversion, Interpolation Methods)			
	Data Compression (Lossless Data Compression, Lossy Data Compression, Psychoacoustics, ISO-MPEG1 Audio Coding)			
Literatur	- U. Zölzer, Digitale Audiosignalverarbeitung, 3. Aufl., B.G. Teubner, 2005 .			
	- U. Zölzer, Digitale Audio Signal Processing, 2nd Edition, J. Wiley & Sons, 2005.			
	- U. Zölzer (Ed), Digital Audio Effects, 2nd Edition, J. Wiley & Sons, 2011.			

Lehrveranstaltung L0651: Digital Audio Signal Processing		
Тур	Hörsaalübung	
SWS	1	
LP	2	
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 46, Präsenzstudium 14	
Dozenten	Prof. Udo Zölzer	
Sprachen	EN	
Zeitraum	WiSe	
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung	
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung	

Modul M1249: Medizi	nische Bildgebung			
Lehrveranstaltungen				
Titel		Тур	SWS	LP
Medizinische Bildgebung (L1694)		Vorlesung	2	3
Medizinische Bildgebung (L1695)		Gruppenübung	2	3
Modulverantwortlicher	Prof. Tobias Knopp			
Zulassungsvoraussetzungen	Keine			
Empfohlene Vorkenntnisse	Grundkenntnisse in Linear Algebra, Numerik und Signa	lverarbeitung		
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studierenden	die folgenden Lernergebnisse err	reicht	
Lernergebnisse				
Fachkompetenz				
Wissen	Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, Rekonstruktionsverfahren für verschieden tomographische Bildgebungsmodalitäten wie die Computertomographie und die Magnetresonanztomographie zu beschreiben. Si kennen die nötigen Grundlagen aus den Bereichen der Signalverarbeitung und der inversen Probleme und kennen sowol analytische als auch iterative Bildrekonstruktionsmethoden. Die Studierenden verfügen über vertiefende Kenntnisse über di Bildgebungoperatoren der Computertomographie und die Magnetresonanztomographie.			e zu beschreiben. Sie und kennen sowohl
Fertigkeiten	Die Studierenden sind dazu in der Lage, Rekonstruktionsverfahren zu implementieren und diese anhand von tomographischen Messdaten zu testen. Sie können die rekonstruierten Bilder visualisieren und die Qualität ihrer Daten und Resultate und beurteilen. Zudem können die Studierenden die zeitliche Komplexität von Bildgebungsalgorithmen abschätzen.			
Personale Kompetenzen				
Sozialkompetenz	Die Studierenden können in sowohl selbstständig a untereinander austauschen und ihre individuellen Stäri	·		en. Sie können sich
Selbstständigkeit	Die Studierenden sind in der Lage ein komplexes Prob zur Lösung des Problems benötigt werden.	llem eigenständig zu untersuche	n und einzuschätzen,	welche Kompetenzen
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 124, Präsenzstudium 56			
Leistungspunkte	6			
Studienleistung	Keine			
Prüfung	Klausur			
Prüfungsdauer und -umfang	90 min			
Zuordnung zu folgenden	Computer Science: Vertiefung II. Intelligenz-Engineerin	g: Wahlpflicht		
Curricula	Elektrotechnik: Vertiefung Medizintechnik: Wahlpflicht			
	Informatik-Ingenieurwesen: Vertiefung I. Informatik: W	ahlpflicht		
	Interdisciplinary Mathematics: Vertiefung III. Computat	ional Methods in Biomedical Imag	ging: Pflicht	
	Microelectronics and Microsystems: Vertiefung Commu	nication and Signal Processing: V	Vahlpflicht	
	Theoretischer Maschinenbau: Vertiefung Bio- und Medi	zintechnik: Wahlpflicht		

Lehrveranstaltung L1694: M	edizinische Bildgebung
Тур	Vorlesung
sws	2
LP	3
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28
Dozenten	Prof. Tobias Knopp
Sprachen	DE/EN
Zeitraum	WiSe
Inhalt	 Überblick über bekannte Bildgebungsverfahren Signalverarbeitung Inverse Probleme Computertomographie Magnetresonanztomographie Compressed Sensing Magnetic-Particle-Pmaging
Literatur	Bildgebende Verfahren in der Medizin; O. Dössel; Springer, Berlin, 2000 Bildgebende Systeme für die medizinische Diagnostik; H. Morneburg (Hrsg.); Publicis MCD, München, 1995 Introduction to the Mathematics of Medical Imaging; C. L.Epstein; Siam, Philadelphia, 2008 Medical Image Processing, Reconstruction and Restoration; J. Jan; Taylor and Francis, Boca Raton, 2006 Principles of Magnetic Resonance Imaging; ZP. Liang and P. C. Lauterbur; IEEE Press, New York, 1999

Lehrveranstaltung L1695: Mo	ehrveranstaltung L1695: Medizinische Bildgebung		
Тур	Gruppenübung		
sws	2		
LP	3		
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28		
Dozenten	Prof. Tobias Knopp		
Sprachen	DE/EN		
Zeitraum	WiSe		
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung		
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung		

Modul M0677: Digital	Signal Processing and Digital F	ilters		
Lehrveranstaltungen				
Titel		Тур	SWS	LP
Digitale Signalverarbeitung und Digitale Signalverarbeitung un		Vorlesung Hörsaalübung	3 2	4 2
Modulverantwortlicher		Horsadiabang	2	2
Zulassungsvoraussetzungen	None			
Empfohlene Vorkenntnisse	Mathematics 1-3			
	 Signals and Systems 			
	 Fundamentals of signal and system the 	eory as well as random processes.		
	Fundamentals of spectral transforms (I	Fourier series, Fourier transform, Laplace tr	ansform)	
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Stud	ierenden die folgenden Lernergebnisse erre	eicht	
Lernergebnisse				
Fachkompetenz				
Wissen	The students know and understand basic alg	orithms of digital signal processing. They a	are familiar with the	spectral transforms of
	discrete-time signals and are able to descri		_	•
	structures of digital filters and can identi			
	effects caused by quantization of filter coef			
	perform traditional and parametric methods of	of spectrum estimation, also taking a limite	d observation windo	w into account.
	The students are familiar with the contents of	f lecture and tutorials. They can explain and	d apply them to new	problems.
Fertigkeiten	The students are able to apply methods of digital signal processing to new problems. They can choose and parameterize suitable			
	filter striuctures. In particular, the can design	adaptive filters according to the minimum	mean squared erro	r (MMSE) criterion an
	develop an efficient implementation, e.g. b	ased on the LMS or RLS algorithm. Furt	hermore, the stude	nts are able to appl
	methods of spectrum estimation and to take	the effects of a limited observation window	into account.	
Personale Kompetenzen				
Sozialkompetenz	The students can jointly solve specific proble	ms.		
Selbstständigkeit	The students are able to acquire relevant	information from appropriate literature	sources. They can	control their level of
	knowledge during the lecture period by solvir	ng tutorial problems, software tools, clicker	system.	
Arbeitszufwand in Stunden	Eigenstudium 110, Präsenzstudium 70			
Leistungspunkte	-			
Studienleistung				
Prüfung	Klausur			
Prüfungsdauer und -umfang	90 min			
Zuordnung zu folgenden	Elektrotechnik: Vertiefung Regelungs- und En	ergiesystemtechnik: Wahlpflicht		
Curricula	Informatik-Ingenieurwesen: Vertiefung II. Inge	enieurwissenschaften: Wahlpflicht		
	Information and Communication Systems: Ve	rtiefung Kommunikationssysteme, Schwerp	ounkt Signalverarbeit	ung: Wahlpflicht
	Mechanical Engineering and Management: Ve	ertiefung Mechatronik: Wahlpflicht		
	Mechatronics: Vertiefung Intelligente Systeme	e und Robotik: Wahlpflicht		
	Microelectronics and Microsystems: Vertiefun	•	/ahlpflicht	
	Theoretischer Maschinenbau: Vertiefung Rob	otik und Informatik: Wahlpflicht		

Lehrveranstaltung L0446: Di	igital Signal Processing and Digital Filters		
Тур	Vorlesung		
sws	3		
LP	4		
	Eigenstudium 78, Präsenzstudium 42		
	Prof. Gerhard Bauch		
Sprachen Zeitraum			
Inhalt			
	Discrete-time Fourier Transform (DTFT)		
	Discrete Fourier-Transform (DFT), Fast Fourier Transform (FFT)		
	Z-Transform		
	Correspondence of continuous-time and discrete-time signals, sampling, sampling theorem		
	Fast convolution, Overlap-Add-Method, Overlap-Save-Method		
	Fundamental structures and basic types of digital filters		
	Characterization of digital filters using pole-zero plots, important properties of digital filters		
	Quantization effects		
	Design of linear-phase filters		
	Fundamentals of stochastic signal processing and adaptive filters		
	MMSE criterion		
	Wiener Filter		
	LMS- and RLS-algorithm		
	Traditional and parametric methods of spectrum estimation		
Literatur	KD. Kammeyer, K. Kroschel: Digitale Signalverarbeitung. Vieweg Teubner.		
	V. Oppenheim, R. W. Schafer, J. R. Buck: Zeitdiskrete Signalverarbeitung. Pearson StudiumA. V.		
	W. Hess: Digitale Filter. Teubner.		
	Oppenheim, R. W. Schafer: Digital signal processing. Prentice Hall.		
	S. Haykin: Adaptive flter theory.		
	L. B. Jackson: Digital filters and signal processing. Kluwer.		
	T.W. Parks, C.S. Burrus: Digital filter design. Wiley.		

Lehrveranstaltung L0447: Digital Signal Processing and Digital Filters		
Тур	Hörsaalübung	
sws	2	
LP	2	
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 32, Präsenzstudium 28	
Dozenten	Prof. Gerhard Bauch	
Sprachen	EN	
Zeitraum	WiSe	
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung	
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung	

Modul M1743: COSIMA	A (Competition in Microsystem Applic	ation)		
Lehrveranstaltungen				
Titel COSIMA (Competition in Microsystem	n Application) (L3094)	Typ Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung	SWS 5	LP 6
Modulverantwortlicher	Prof. Hoc Khiem Trieu			
Zulassungsvoraussetzungen	None			
Empfohlene Vorkenntnisse	Knowledge of microsystems operation and application.			
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studierenden o	die folgenden Lernergebnisse erreicht		
Lernergebnisse				
Fachkompetenz				
Wissen	Consolidation of knowledge in the application of microsystems with practical relevance. Learning how an idea could turn into a product.			
Fertigkeiten	Realization of a concrete system by integrating hardware components and, under certain circumstances, software into a demonstrator. Development of a business plan for the innovative product. Convincing companies to sponsor the project. Presentation of the project in the form of an exposé.			
Personale Kompetenzen				
Sozialkompetenz	Students work in groups of 3 to 4 participants each to implement their project idea. The division of tasks takes place within the group, taking into account the complementary skills of the members.			
Selbstständigkeit	The groups work on the project independently from the idea to the implementation. Supervision is provided through joint analysis of the problems and advice to the students.			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 110, Präsenzstudium 70			
Leistungspunkte	6			
Studienleistung	Keine			
Prüfung	Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit			
Prüfungsdauer und -umfang	60 Minuten			
Zuordnung zu folgenden	Microelectronics and Microsystems: Vertiefung Commu	nication and Signal Processing: Wahlpt	licht	
Curricula	Microelectronics and Microsystems: Vertiefung Embedo	•		
	Microelectronics and Microsystems: Vertiefung Microele	ectronics Complements: Wahlpflicht		

Lehrveranstaltung L3094: CC	ehrveranstaltung L3094: COSIMA (Competition in Microsystem Application)			
Тур	Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung			
sws	5			
LP	6			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 110, Präsenzstudium 70			
Dozenten	Prof. Hoc Khiem Trieu, Dozenten des Studiengangs			
Sprachen	EN			
Zeitraum	WiSe/SoSe			
Inhalt				
Literatur				

Fachmodule der Vertiefung Embedded Systems

M. J. I. MOZOZ. B. J. J.						
Modul M0791: Rechne	erarchitektur					
Lehrveranstaltungen						
Titel	-			Тур	sws	LP
Rechnerarchitektur (L0793)				Vorlesung	2	3
Rechnerarchitektur (L0794)				Projekt-/problembasierte	2	2
				Lehrveranstaltung		
Rechnerarchitektur (L1864)				Gruppenübung	1	1
Modulverantwortlicher	1					
Zulassungsvoraussetzungen Empfohlene Vorkenntnisse		ormatik"				
Linpromene vorkemitiisse	Modul Technische init	omiatik				
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Tei	Inahme haben die Studier	enden die folger	nden Lernergebnisse erreich	t	
Lernergebnisse						
Fachkompetenz						
Wissen	In diesem Modul werd	en fortgeschrittene Konze	pte der Rechner	architektur vorgestellt. Am <i>A</i>	Anfang steht ein	breiter Überblick über
	mögliche Programmie	rmodelle, wie sie für Univ	ersalrechner abe	er auch für spezielle Maschir	nen (z.B. Signalpr	rozessoren) entwickelt
	wurden. Anschließend	werden prinzipielle Aspe	kte der Mikroarc	hitektur von Prozessoren be	handelt. Der Sch	werpunkt liegt hierbei
	insbesondere auf dem	n sogenannten Pipelining	und den in dies	em Zusammenhang angew	andten Methode	n zur Beschleunigung
	der Befehlsausführun	ig. Die Studierenden le	rnen Mechanisn	nen zum dynamischen Sc	heduling, zur S	Sprungvorhersage, zu
	superskalaren Architel	kturen und zu Speicher-Hi	erarchien kenne	n.		
Fertigkeiten	Die Studierenden sind	l in der Lage, den Aufbau	eines Prozessor	s zu erklären. Sie kennen d	ie verschiedener	n Architekturprinzipien
	und Programmiermod	lelle. Die Studierenden u	intersuchen vers	schiedene Strukturen von F	ipeline-Architekt	uren und sind in der
	Lage, deren Konzepte	zu erklären und im Hinbli	ck auf Kriterien v	vie Performance und Energi	eeffizienz zu anal	lysieren. Sie bewerten
	unterschiedliche Spe	eicherarchitekturen, ken	nen parallele	Rechnerarchitekturen und	d können zwis	schen Befehls- und
	Datenparallelität unter	rscheiden.				
Personale Kompetenzen						
Sozialkompetenz	Die Studierenden sind	nach Abschluss des Mod	uls in der Lage,	ähnliche Aufgaben alleine o	der in einer Grup	ope zu bearbeiten und
	die Resultate geeignet	t zu präsentieren.				
Selhstständigkeit	Die Studierenden sind	d nach Abschluss des M	oduls in der Lac	ge, sich Teilbereiche des Fa	achgebietes anh	and von Fachliteratur
Selbststanlagkeit				enzufassen, zu präsentiere	-	
	Lehrveranstaltungen z			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	_	·				
Arbeitsaufwand in Stunden		isenzstudium 70				
Leistungspunkte	6 Verpflichtend Bonus	Art der Studienleistung	Beschreibung			
Studienleistung	Nein 15 %	Fachtheoretisch-	beschreibung			
	25 70	fachpraktische				
		Studienleistung				
Prüfung	Klausur					
Prüfungsdauer und -umfang		off + 4 Testate zur PBL "R	echnerarchitektu	r"		
Zuordnung zu folgenden	Allgemeine Ingenieurv	Allgemeine Ingenieurwissenschaften (7 Semester): Vertiefung Informatik: Wahlpflicht				
Curricula		rtiefung Computer- und S				
	Computer Science: Ve	rtiefung I. Computer- und	Software-Engine	ering: Wahlpflicht		
	Flugzeug-Systemtechr	nik: Kernqualifikation: Wal	nlpflicht			
	Flugzeug-Systemtechr	nik: Vertiefung Avionik un	d eingebettete S	ysteme: Wahlpflicht		
	General Engineering S	science (7 Semester): Vert	iefung Informatil	k: Wahlpflicht		
	Informatik-Ingenieurw	esen: Vertiefung I. Inform	atik: Wahlpflicht			
	Microelectronics and M	Microsystems: Vertiefung	Embedded Syste	ms: Wahlpflicht		

Lehrveranstaltung L0793: Re	echnerarchitektur
Тур	Vorlesung
sws	2
LP	3
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28
Dozenten	Prof. Heiko Falk
Sprachen	DE/EN
Zeitraum	WiSe
Inhalt	 Einführung Grundlagen von VHDL Programmiermodelle Realisierung elementarer Datentypen Dynamisches Scheduling Sprungvorhersage Superskalare Maschinen Speicher-Hierarchien Die Gruppenübungen vertiefen die Vorlesungsinhalte durch Bearbeiten und Besprechen von Übungsblättern und dienen somit zur Klausur-Vorbereitung. Der praktische Umgang mit Fragestellungen aus der Rechnerarchitektur wird in der FPGA-basierten PBL zur Rechnerarchitektur vermittelt, deren Teilnahme verpflichtend ist.
Literatur	 D. Patterson, J. Hennessy. Rechnerorganisation und -entwurf. Elsevier, 2005. A. Tanenbaum, J. Goodman. Computerarchitektur. Pearson, 2001.

Lehrveranstaltung L0794: Re	ehrveranstaltung L0794: Rechnerarchitektur			
Тур	Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung			
sws	2			
LP	2			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 32, Präsenzstudium 28			
Dozenten	Prof. Heiko Falk			
Sprachen	DE/EN			
Zeitraum	WiSe			
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung			
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung			

Lehrveranstaltung L1864: Re	ehrveranstaltung L1864: Rechnerarchitektur				
Тур	Gruppenübung				
SWS	1				
LP	1				
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 16, Präsenzstudium 14				
Dozenten	Prof. Heiko Falk				
Sprachen	DE/EN				
Zeitraum	WiSe				
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung				
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung				

MICIOSYSTEIRS					
Modul M0924: Softwa	re für Eingeb	ettete Systeme			
Lehrveranstaltungen					
Titel			Тур	SWS	LP
Software für Eingebettete Systeme			Vorlesung	2	3
Software für Eingebettete Systeme			Gruppenübung	3	3
Modulverantwortlicher	Prof. Bernd-Christia	an Renner			
Zulassungsvoraussetzungen	Keine				
Empfohlene Vorkenntnisse	• Cobrauto K	anntnices and Erfahrung in	Drogrammiorenzacho C		
	_	enntnisse und Erfahrung ir	i Programmiersprache C		
		nisse in Softwaretechnik	or Carachan		
	• Prinzipielles	Verständnis von Assemble	er Sprachen		
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher	Teilnahme haben die Stud	dierenden die folgenden Lernergebni	sse erreicht	
Lernergebnisse					
Fachkompetenz					
Wissen	Studierende könne	en die grundlegende Prinzi	pien und Vorgehensweisen für die E	Erstellung von Software für	eingebettete Systeme
			rte Programmiertechniken mittels II	•	
			rs. Die Teilnehmer sind in der Lage,	·	
			rithmen für Echzeitbetriebssysteme	-	•
		3 3	,		
Fertigkeiten	Studierende erstel	llen interrupt-basierte Pr	ogramme für einen konkreten Mil	krocontroller. Sie erstellen	und benutzen einer
	preemptiven sched	duler. Sie setzen periphere	Komponenten (Timer, ADCs, EEPRC	M) für komplexe Aufgaber	eingebetteter System
	ein. Für den Anschl	luss externer Komponente	n setzen sie serielle Protokolle ein.		
Personale Kompetenzen					
Sozialkompetenz					
Selbstständigkeit					
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 110,	Präsenzstudium 70			
Leistungspunkte	6				
Studienleistung	Verpflichtend Bonus	Art der Studienleistung	Beschreibung		
	Nein 10 %	Testate			
Prüfung	Klausur				
Prüfungsdauer und -umfang	90 min				
Zuordnung zu folgenden	Computer Science:	Vertiefung I. Computer- u	nd Software-Engineering: Wahlpflich	nt	
Curricula	Elektrotechnik: Ver	tiefung Nachrichten- und	Kommunikationstechnik: Wahlpflicht		
	Information and Co	ommunication Systems: Ve	ertiefung Kommunikationssysteme, S	Schwerpunkt Software: Wah	lpflicht
	Mechatronics: Tech	nnischer Ergänzungskurs: '	Wahlpflicht		
	Mechatronics: Vert	iefung Intelligente System	e und Robotik: Wahlpflicht		
		iefung Systementwurf: Wa			
	Microelectronics ar	nd Microsystems: Vertiefur	ng Embedded Systems: Wahlpflicht		

Lehrveranstaltung L1069: So	oftware für Eingebettete Systeme					
Тур	Vorlesung					
sws	2					
LP	}					
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28					
Dozenten	Prof. Bernd-Christian Renner					
Sprachen	DE/EN					
Zeitraum	SoSe					
Inhalt	 General-Purpose Processors Programming the Atmel AVR Interrupts C für Embedded Systems Standard Single Purpose Processors: Peripherals Finite-State Machines Speicher Betriebssystem für Eingebettete Systeme Echtzeit Eingebettete Systeme 					
Literatur	 Embedded System Design, F. Vahid and T. Givargis, John Wiley Programming Embedded Systems: With C and Gnu Development Tools, M. Barr and A. Massa, O'Reilly C und C++ für Embedded Systems, F. Bollow, M. Homann, K. Köhn, MITP The Art of Designing Embedded Systems, J. Ganssle, Newnses Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-RISC-Familie, G. Schmitt, Oldenbourg Making Embedded Systems: Design Patterns for Great Software, E. White, O'Reilly 					

Modulhandbuch M.Sc. "Microelectronics and Microsystems"

Lehrveranstaltung L1070: So	ehrveranstaltung L1070: Software für Eingebettete Systeme			
Тур	Gruppenübung			
SWS	3			
LP	3			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 48, Präsenzstudium 42			
Dozenten	Prof. Bernd-Christian Renner			
Sprachen	DE/EN			
Zeitraum	SoSe			
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung			
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung			

Modul M1400: Entwur	rf von Dependa	ble Systems				
Lehrveranstaltungen						
Titel			Тур	sws	LP	
Entwurf von Dependable Systems (1 2000)		Vorlesung	2	3	
Entwurf von Dependable Systems (Gruppenübung	2	3	
Modulverantwortlicher			,			
Zulassungsvoraussetzungen						
Empfohlene Vorkenntnisse	Grundlegende Kenntr	nisse zu Datenstrukturen	und Algorithmen			
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Te	ilnahme haben die Studie	erenden die folgenden Lernergebnisse erro	eicht		
Lernergebnisse						
Fachkompetenz						
Wissen	Im Folgenden wird "	'Dependable" als Zusam	menfassung von Zuverlässigkeit, Verfügl	oarkeit, Wartbarkeit,	Sicherheit (Safety 8	
	Security) verwendet.					
	Kenntnis von Ansätze	en zum Entwurf von Depe	ndable Systems 7 B			
	Remains von Ansacze	in Zam Enewari von Bepe	nausic systems, 2.b.			
	Strukturelle Lösungen wie z.B. Modular Redundancy					
	Algorithmische Lösungen wie z.B. Behandlung Byzantinischer Fehler, Checkpointing, etc.					
	Kenntnis von Method	en zur Analyse der Deper	ndability von Systemen			
Fertigkeiten	Fähigkeit zum Entwu	rf von Dependable Syster	ns durch Implementierung der obigen Ans	ätze.		
	Fähigkeit zur Analyse	der Dependability von S	ystemen durch Anwendung der obigen An	alysemethoden.		
Personale Kompetenzen						
Sozialkompetenz	Studierende können					
	die jeweiligen Konzepte diskutieren und erläutern sowie					
	die Jeweiligen Konzepte diskutieren und erlautern sowie die Lösungen mündlich darstellen.					
	are zosangen i	nananen aarbeenen				
Selbstständigkeit			selbständig vertiefende Zusammenhän	ge der Konzepte au	s der Vorlesung und	
	erweiterte Lösungsve	erfahren.				
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 124, Pr	äsenzstudium 56				
Leistungspunkte						
Studienleistung	Verpflichtend Bonus	Art der Studienleistung	Beschreibung			
	Ja Keiner	Fachtheoretisch-	Die Lösung einer Aufgabe ist Zusla	-	g tur die Prutung. Di	
		fachpraktische Studienleistung	Aufgabe wird in Vorlesung und Übun	g definiert.		
Prüfung	Mündliche Prüfung	Studienleistung				
Prüfungsdauer und -umfang						
		ertiefung L Computer- un	d Software-Engineering: Wahlpflicht			
		vesen: Vertiefung I. Inforr				
Carricula	_		tiefung Sichere und zuverlässige IT-Syster	ne: Wahlpflicht		
	Mechatronics: Vertiefung Systementwurf: Wahlpflicht					
		• •	Embedded Systems: Wahlpflicht			

Lehrveranstaltung L2000: En	ntwurf von Dependable Systems
Тур	Vorlesung
sws	2
LP	3
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28
Dozenten	Prof. Görschwin Fey
Sprachen	DE/EN
Zeitraum	SoSe
Inhalt	Beschreibung
	Der Begriff "Dependability" umfasst verschiedene Aspekte eines Systems. Dies sind typischer Weise:
	 Zuverlässigkeit Verfügbarkeit Wartbarkeit Sicherheit - Safety & Security Damit ist Dependability ein zentraler Aspekt, der früh im Systementwurf betrachtet werden muss. Dies gilt für Software,
	Eingebette Systeme wie auch umfassende Cyber-Physical Systems. Inhalt Das Modul führt grundlegende Konzept zum Entwurf und zur Analyse von Dependable Systems ein. Entwurfsbeispiele dienen dazu,
	eigene praktische Erfahrung zu sammeln. Ein Schwerpunkt des Moduls liegt im Bereich eingebetteter Systeme. Folgende Gebiete werden betrachtet: • Modellierung • Fehlertoleranz • Entwurfskonzepte • Analyse von Systemen
Literatur	

ehrveranstaltung L2001: Entwurf von Dependable Systems				
Тур	Gruppenübung			
sws	2			
LP	3			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28			
Dozenten	Prof. Görschwin Fey			
Sprachen	DE/EN			
Zeitraum	SoSe			
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung			
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung			

Modul M1743: COSIMA	A (Competition in Microsys	stem Application)			
Lehrveranstaltungen					
Titel			Тур	sws	LP
COSIMA (Competition in Microsyster	m Application) (L3094)		Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung	5	6
Modulverantwortlicher	Prof. Hoc Khiem Trieu				
Zulassungsvoraussetzungen	None				
Empfohlene Vorkenntnisse					
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben d	ie Studierenden die folger	nden Lernergebnisse erreicht		
Lernergebnisse					
Fachkompetenz					
Wissen					
Fertigkeiten					
Personale Kompetenzen					
Sozialkompetenz					
Selbstständigkeit					
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 110, Präsenzstudium 70				
Leistungspunkte	6				
Studienleistung	Keine				
Prüfung	Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit				
Prüfungsdauer und -umfang	60 Minuten				
Zuordnung zu folgenden	Microelectronics and Microsystems: Ve	ertiefung Microelectronics	Complements: Wahlpflicht		
Curricula	Microelectronics and Microsystems: Ve	ertiefung Microelectronics	Complements: Wahlpflicht		
	Microelectronics and Microsystems: Ve	-			
	Microelectronics and Microsystems: Ve	-		flicht	
	Microelectronics and Microsystems: Ve	,			
	Microelectronics and Microsystems: Ve	ertiefung Embedded Syste	ems: Wahlpflicht		

Lehrveranstaltung L3094: COSIMA (Competition in Microsystem Application)		
Тур	Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung	
SWS	5	
LP	6	
Arbeitsaufwand in Stunden	genstudium 110, Präsenzstudium 70	
Dozenten	of. Hoc Khiem Trieu, Dozenten des Studiengangs	
Sprachen		
Zeitraum	WiSe/SoSe	
Inhalt		
Literatur		

Modul M0803: Embed	ded Systems				
Lehrveranstaltungen					
Titel			Тур	SWS	LP
Eingebettete Systeme (L0805)			Vorlesung	3	4
Eingebettete Systeme (L0806)			Gruppenübung	1	2
Modulverantwortlicher	Prof. Heiko Falk				
Zulassungsvoraussetzungen	None				
Empfohlene Vorkenntnisse	Computer Engineering	9			
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Te	ilnahme haben die Studiere	nden die folgenden Lernergebnisse erre	eicht	
Lernergebnisse					
Fachkompetenz					
Wissen	Embedded systems c	an be defined as informatio	n processing systems embedded into e	nclosing products. Th	nis course teaches the
	foundations of such s	ystems. In particular, it dea	ls with an introduction into these syste	ms (notions, commo	n characteristics) and
	their specification lar	nguages (models of compu	tation, hierarchical automata, specifica	ation of distributed s	systems, task graphs,
	specification of real-ti	me applications, translation	s between different models).		
	Another part covers	the hardware of embedde	d systems: Sonsors, A/D and D/A conv	verters real-time ca	nable communication
			ergy dissipation, reconfigurable logic a		
		•	niddleware and real-time scheduling.		
		, , ,	dware/software partitioning, high-level		
		compilers for embedded pro			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Fertigkeiten	_		I be able to realize simple embedded		
	·		ise in order to obtain a functional embe		•
		·	ns and feasible techniques for system-le	evel design. They sh	all be able to judge in
	which areas of embed	lded system design specific	risks exist.		
Personale Kompetenzen					
Sozialkompetenz	Students are able to s	solve similar problems alone	e or in a group and to present the result	s accordingly.	
Selbstständigkeit	Students are able to a	acquire new knowledge fron	n specific literature and to associate this	knowledge with oth	er classes.
Arbeitsaufwand in Stunden	Figonstudium 124 Pr	äconzetudium E6			
Leistungspunkte		asenzstudium 50			
Studienleistung		Art der Studienleistung	Beschreibung		
	Ja 10 %	Fachtheoretisch-			
		fachpraktische			
		Studienleistung			
Prüfung	Klausur				
Prüfungsdauer und -umfang	90 Minuten, Inhalte de	er Vorlesung und Übungen			
Zuordnung zu folgenden	Allgemeine Ingenieum	wissenschaften (7 Semester): Vertiefung Informatik: Pflicht		
Curricula	Computer Science: Ve	ertiefung Computer- und So	tware-Engineering: Wahlpflicht		
	Computer Science: Ve	ertiefung I. Computer- und S	oftware-Engineering: Wahlpflicht		
	Elektrotechnik: Kernq	ualifikation: Wahlpflicht			
		Vertiefung Mechatronics: W	·		
		nik: Kernqualifikation: Wahl			
			efung Mechatronics: Wahlpflicht		
	_	resen: Kernqualifikation: Pfli			
		ung Systementwurf: Wahlpf			
		ung Intelligente Systeme un	d Robotik: Wahlpflicht		
	Mechatronik: Kernqua	•	about the first of the second		
	Microelectronics and I	Microsystems: Vertiefung Ei	nbedded Systems: Wahlpflicht		

Lehrveranstaltung L0805: En	nbedded Systems		
Тур	Vorlesung		
sws	3		
LP			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 78, Präsenzstudium 42		
Dozenten	Prof. Heiko Falk		
Sprachen	EN		
Zeitraum	SoSe		
Inhalt	 Introduction Specifications and Modeling Embedded/Cyber-Physical Systems Hardware System Software Evaluation and Validation Mapping of Applications to Execution Platforms Optimization 		
Literatur	 Peter Marwedel. Embedded System Design - Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems. 2 nd Edition, Springer, 2012., Springer, 2012. 		

Lehrveranstaltung L0806: En	ehrveranstaltung L0806: Embedded Systems		
Тур	Gruppenübung		
sws	1		
LP	2		
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 46, Präsenzstudium 14		
Dozenten	Prof. Heiko Falk		
Sprachen	EN		
Zeitraum	SoSe		
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung		
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung		

Modul M0925: Digital	Circuit Design				
Lehrveranstaltungen					
Titel		Тур	sws	LP	
Entwurf Digitaler Schaltungen (L069	98)	Vorlesung	2	3	
Erweiterter Digitaler Schaltungsent	wurf (L0699)	Vorlesung	2	3	
Modulverantwortlicher	Prof. Matthias Kuhl				
Zulassungsvoraussetzungen	None				
Empfohlene Vorkenntnisse					
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben	die Studierenden die folgenden Lernergebnisse err	eicht		
Lernergebnisse					
Fachkompetenz					
Wissen					
Fertigkeiten					
Personale Kompetenzen					
Sozialkompetenz					
Selbstständigkeit					
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 124, Präsenzstudium 5	56			
Leistungspunkte	6				
Studienleistung	Keine				
Prüfung	Mündliche Prüfung				
Prüfungsdauer und -umfang	40 min				
Zuordnung zu folgenden	Elektrotechnik: Vertiefung Nanoelekt	ronik und Mikrosystemtechnik: Wahlpflicht			
Curricula	Internationales Wirtschaftsingenieur	wesen: Vertiefung II. Elektrotechnik: Wahlpflicht			
	Mechanical Engineering and Manager	ment: Vertiefung Mechatronik: Wahlpflicht			
	Microelectronics and Microsystems: \	Vertiefung Microelectronics Complements: Wahlpfli	cht		
	Microelectronics and Microsystems: \	Vertiefung Embedded Systems: Wahlpflicht			

Lehrveranstaltung L0698: Di	ehrveranstaltung L0698: Digital Circuit Design		
Тур	Vorlesung		
SWS	2		
LP	3		
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28		
Dozenten	Prof. Volkhard Klinger		
Sprachen	EN		
Zeitraum	WiSe		
Inhalt			
Literatur			

Lehrveranstaltung L0699: Ad	ehrveranstaltung L0699: Advanced Digital Circuit Design		
Тур	Vorlesung		
sws	2		
LP	3		
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28		
Dozenten	Prof. Volkhard Klinger		
Sprachen	EN		
Zeitraum	SoSe		
Inhalt			
Literatur			

Modul M1687: Selecte	d Aspects of Embedded Syst	ems			
Lehrveranstaltungen					
Titel		Тур	sws	LP	
Ausgewählte Aspekte Eingebetteter	-	Vorlesung	3	4	
Ausgewählte Aspekte Eingebetteter	Systeme (L2677)	Gruppenübung	1	2	
Modulverantwortlicher	Prof. Hoc Khiem Trieu				
Zulassungsvoraussetzungen	None				
Empfohlene Vorkenntnisse					
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die S	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studierenden die folgenden Lernergebnisse erreicht			
Lernergebnisse					
Fachkompetenz					
Wissen					
Fertigkeiten					
Personale Kompetenzen					
Sozialkompetenz					
Selbstständigkeit					
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 124, Präsenzstudium 56				
Leistungspunkte	6				
Studienleistung	Keine				
Prüfung	Mündliche Prüfung				
Prüfungsdauer und -umfang	30 min				
Zuordnung zu folgenden	Microelectronics and Microsystems: Vertie	fung Embedded Systems: Wahlpflicht			
Curricula	•	-			

Lehrveranstaltung L2676: Se	ehrveranstaltung L2676: Selected Aspects of Embedded Systems		
Тур	Vorlesung		
sws	3		
LP	4		
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 78, Präsenzstudium 42		
Dozenten	Dozenten des SD E		
Sprachen	EN		
Zeitraum	WiSe/SoSe		
Inhalt			
Literatur			

Lehrveranstaltung L2677: Se	Lehrveranstaltung L2677: Selected Aspects of Embedded Systems		
Тур	Gruppenübung		
SWS	1		
LP	2		
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 46, Präsenzstudium 14		
Dozenten	Dozenten des SD E		
Sprachen	EN		
Zeitraum	WiSe/SoSe		
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung		
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung		

Modul M1743: COSIM	A (Competition in Microsystem	Application)			
Lehrveranstaltungen					
Titel COSIMA (Competition in Microsyste	m Application) (L3094)		Typ Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung	sws 5	LP 6
Modulverantwortlicher	Prof. Hoc Khiem Trieu				
Zulassungsvoraussetzungen	None				
Empfohlene Vorkenntnisse	Knowledge of microsystems operation and ap	Knowledge of microsystems operation and application.			
	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Stud	lierenden die folgen	den Lernergebnisse erreich	t	
Lernergebnisse					
Fachkompetenz <i>Wissen</i>	Consolidation of knowledge in the application product.	on of microsystems	with practical relevance. L	earning how an i	idea could turn into a
Fertigkeiten	Realization of a concrete system by integrating hardware components and, under certain circumstances, software into a demonstrator. Development of a business plan for the innovative product. Convincing companies to sponsor the project. Presentation of the project in the form of an exposé.				
Personale Kompetenzen					
Sozialkompetenz	Students work in groups of 3 to 4 participants each to implement their project idea. The division of tasks takes place within the group, taking into account the complementary skills of the members.				
Selbstständigkeit	The groups work on the project independently from the idea to the implementation. Supervision is provided through joint analysis of the problems and advice to the students.				
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 110, Präsenzstudium 70				
Leistungspunkte	6				
Studienleistung	Keine				
Prüfung	Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit				
Prüfungsdauer und -umfang	60 Minuten				
	Microelectronics and Microsystems: Vertiefur Microelectronics and Microsystems: Vertiefur Microelectronics and Microsystems: Vertiefur	ng Embedded Syster	ms: Wahlpflicht	pflicht	

Lehrveranstaltung L3094: CC	Lehrveranstaltung L3094: COSIMA (Competition in Microsystem Application)		
Тур	jekt-/problembasierte Lehrveranstaltung		
sws	5		
LP	6		
Arbeitsaufwand in Stunden	genstudium 110, Präsenzstudium 70		
Dozenten	of. Hoc Khiem Trieu, Dozenten des Studiengangs		
Sprachen			
Zeitraum	WiSe/SoSe		
Inhalt			
Literatur			

Modul M0910: Fortge	schrittener Entwurf von Chip-Systeme	en (Praktikum)		
Lehrveranstaltungen				
Titel Fortgeschrittener Entwurf von Chip-	-Systemen (L1061)	Typ Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung	SWS 3	LP 6
Modulverantwortlicher	Prof. Heiko Falk			
Zulassungsvoraussetzungen	Keine			
Empfohlene Vorkenntnisse	Erfolgreiche Teilnahme am praktischen FPGA-Labor des	Moduls "Rechnerarchitektur" ist zwin	gende Vorauss	etzung.
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studierenden	die folgenden Lernergebnisse erreicht		
Lernergebnisse				
Fachkompetenz				
Wissen	In diesem Modul werden fortgeschrittene Konzepte der Rechnerarchitektur praxisorientiert vermittelt. Mit Hilfe der Hardwa Beschreibungssprache VHDL und rekonfigurierbarer FPGA-Hardware lernen Studierende, wie komplexe Rechensysteme (s Systems-on-Chip, SoCs), wie sie insbesondere im Bereich der eingebetteten Systeme anzutreffen sind, in Hardware zu entwe sind.			Rechensysteme (sog.
	Ausgehend von einer einfachen Prozessor-Architektur lernen Studierende, die Verarbeitung von Befehlen durch eine Maschim nach dem Pipelining-Prinzip zu realisieren. Sie implementieren verschiedene Formen Cache-basierter Speicher-Hierarchier untersuchen Ansätze zum dynamischen Scheduling von Maschinenbefehlen und zur Sprungvorhersage, und konstruieren letztlic ein komplexes MPSoC-System (multi-processor system-on-chip), das aus mehreren Kernen besteht, die über einen gemeinsame Bus verbunden sind.			
Fertigkeiten	Die Studierenden können analysieren, wie hochs Einzelkomponenten zusammengesetzt werden. Sie Rechensystem und der darauf ausgeführten Softwa Auswirkungen hardwarenaher Entwurfsentscheidunge geeignete Optionen vorzuschlagen.	sind in der Lage, die Wechselwirk ire beurteilen zu können. Sie soller	ungen zwische n so in die L	en einem physischen age versetzt werden,
Personale Kompetenzen				
-	Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in d die Resultate geeignet zu präsentieren.	er Lage, ähnliche Aufgaben alleine od	er in einer Gru	ope zu bearbeiten und
Selbstständigkeit	Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in selbständig zu erarbeiten, das erworbene Wissen in kr und es mit den Inhalten anderer Lehrveranstaltungen z	onkrete Implementierungen komplexe	-	
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 138, Präsenzstudium 42			
Leistungspunkte	6			
Studienleistung	Keine			
Prüfung	Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit			
Prüfungsdauer und -umfang	VHDL-Code und FPGA-basierte Implementierungen			
Zuordnung zu folgenden	Computer Science: Vertiefung I. Computer- und Softwa	re-Engineering: Wahlpflicht		
Curricula	Microelectronics and Microsystems: Vertiefung Embedo	led Systems: Wahlpflicht		

Lehrveranstaltung L1061: Fo	rtgeschrittener Entwurf von Chip-Systemen
Тур	Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung
SWS	3
LP	6
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 138, Präsenzstudium 42
Dozenten	Prof. Heiko Falk
Sprachen	DE/EN
Zeitraum	WiSe
Inhalt	 Einführung in grundlegende Technologien (FPGAs, MIPS Einzelzyklus-Maschine) Fließband-Befehlsverarbeitung Cache-basierte Speicher-Hierarchien Busse und Bus-Arbitrierung Multi-Prozessor Chip-Systeme Optional: Fortgeschrittene Fließband-Konzepte (Dynamisches Scheduling, Sprungvorhersage)
Literatur	 D. Patterson, J. Hennessy. Rechnerorganisation und -entwurf. Elsevier, 2005. A. Tanenbaum, J. Goodman. Computerarchitektur. Pearson, 2001. A. Clements. The Principles of Computer Hardware. 3. Auflage, Oxford University Press, 2000.

Modul M1842: GPU Ar	chitectures			
Lehrveranstaltungen				
Titel		Тур	sws	LP
GPU Architecture (L3039)		Vorlesung	3	4
GPU Architecture (L3040)		Projekt-/problembasierte	1	2
		Lehrveranstaltung		
Modulverantwortlicher	Prof. Sohan Lal			
Zulassungsvoraussetzungen	None			
Empfohlene Vorkenntnisse	An introductory module on computer			
	engineering or computer architecture, and good pro	gramming skills in C/C++.		
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studierend	en die folgenden Lernergebnisse erreicht		
Lernergebnisse				
Fachkompetenz				
Wissen				
Fertigkeiten				
Personale Kompetenzen				
Sozialkompetenz				
Selbstständigkeit				
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 124, Präsenzstudium 56			
Leistungspunkte	6			
Studienleistung	Keine			
Prüfung	Mündliche Prüfung			
Prüfungsdauer und -umfang	30 min			
Zuordnung zu folgenden	Computer Science: Vertiefung I. Computer- und Soft	ware-Engineering: Wahlpflicht	•	
Curricula	Information and Communication Systems: Verti	efung Sichere und zuverlässige IT-Sy	steme, Schwei	rpunkt Software und
	Signalverarbeitung : Wahlpflicht			
	Microelectronics and Microsystems: Vertiefung Emb	edded Systems: Wahlpflicht		

Lehrveranstaltung L3039: GPU Architecture				
Тур	Vorlesung			
sws	3			
LP	4			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 78, Präsenzstudium 42			
Dozenten	Prof. Sohan Lal			
Sprachen	EN			
Zeitraum	SoSe			
Inhalt	- Review of computer architecture basics - measuring performance,			
	benchmarks, five-stage RISC pipeline, caches			
	- GPU basics - evolution of GPU computing, a high-level overview of a			
	GPU architecture			
	- GPU programming with CUDA - program structure, CUDA threads			
	organization, warp/thread-block scheduling			
	- GPU (micro) architecture - streaming multiprocessors, single			
	instruction multiple threads (SIMT) core design, tensor/RT cores,			
	mixed-precision support			
	- GPU memory hierarchy - banked register file and operand collectors,			
	shared memory, GPU caches (differences w.r.t. CPU caches), global memory			
	Branch and memory divergence - branch handling, stack-based			
	reconvergence, memory coalescing, coalescer design			
	- Barriers and synchronization			
	- Temporal and spatial locality exploitation challenges in GPU caches			
	- Global memory- high throughput requirements, GDDR/HBM, memory			
	bandwidth optimization techniques			
	- GPU research issues - performance bottlenecks, GPU power modeling,			
	high-power consumption/energy efficiency, GPU security			
	- Application case study - deep learning			
	- Cycle accurate simulators for GPUs			
	The learning in the lectures will be augmented by a semester-long			
	problem-based project.			
Literatur				

Modulhandbuch M.Sc. "Microelectronics and Microsystems"

Lehrveranstaltung L3040: GPU Architecture			
Тур	Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung		
SWS	1		
LP	2		
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 46, Präsenzstudium 14		
Dozenten	Prof. Sohan Lal		
Sprachen	EN		
Zeitraum	SoSe		
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung		
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung		

Fachmodule der Vertiefung Microelectronics Complements

In der Vertiefungsrichtung Microelectronics Complements erweitern die Studierenden ihr Wissen in Richtung spezieller Anwendungsfelder, wie zum Beispiel die Anwendung von Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik in der Medizintechnik, die Verarbeitung digitaler Signale, dem Entwurf und Design von hochkomplexen integrierten Systemen oder von Netzen für optische Nachrichtenübertragung. Sie verfestigen so ihr theoretisches Wissen durch die Analyse von praktischen Anwendungsbeispielen und verknüpfen es mit den Anforderungen, die technische Realisierungen stellen.

Alle Studierende müssen aus dieser Vertiefungsrichtung Lehrveranstaltungen mit einem Umfang von insgesamt 18 Leistungspunkten belegen.

Modul M1611: Silicon	Photonics			
Lehrveranstaltungen				
Titel		Тур	sws	LP
Silizium Photonik (L2408)		Vorlesung	2	4
Silizium Photonik (L2418)		Projekt-/problembasierte	2	2
		Lehrveranstaltung		
Modulverantwortlicher	Dr. Timo Lipka			
Zulassungsvoraussetzungen				
Empfohlene Vorkenntnisse	Basics in physics, optics, microsystem and semiconduct	or technology		
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studierenden d	ie folgenden Lernergebnisse erreicl	nt	
Lernergebnisse				
Fachkompetenz				
Wissen	The students know the fundamentals of silicon photo fabrication techniques.	onics and about the most importa	nt and common	y used materials and
Fertigkeiten	to explain the basic principles of silicon photonics to describe photonic circuit devices and their wor to describe the manufacturing of silicon photon process flows and the impact thereof on the fabric Students are capable to analyze the feasibility of integrated photonic circuit choose appropriate tools and methods to design	king principle nic devices and to discuss in deta cation of photonic integrated circui uit components	ails the relevant	•
Personale Kompetenzen	develop process flows for the fabrication			
Sozialkompetenz	Students are able to prepare and perform their lab experience of audience.	eriments in team work as well as to	present and disc	uss the results in front
Selbstständigkeit	none			
	Eigenstudium 124, Präsenzstudium 56			
Leistungspunkte				
Studienleistung				
_	Mündliche Prüfung			
Prüfungsdauer und -umfang	30 min			
Zuordnung zu folgenden	Microelectronics and Microsystems: Vertiefung Microele	ctronics Complements: Wahlpflicht		
Curricula				

Lehrveranstaltung L2408: Sil	icon Photonics
Тур	Vorlesung
sws	2
LP	4
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 92, Präsenzstudium 28
Dozenten	Dr. Timo Lipka
Sprachen	EN
Zeitraum	WiSe
Inhalt	 Introduction (historical view and trends in der Silicon Photonics) Fabrication Technology (SOI-Wafer, Deposition, Sputtering and Evaporation, Epitaxy, MOCVD, Lithography) Planar Waveguide Fundamentals Optical Materials in silicon Photonics Waveguide Types (Loss Mechanisms, Dispersion and Polarisation in Waveguides) Coupling of Silicon Photonic Devices and Systems Silicon Photonic Circuit Devices and Building Blocks (Passive Devices: Resonators, Interferometers, Mode Converters, Power Splitters, Gratings, Polarizers and Rotators) Material fundamentals and components for tuning and switching Integration of active Devices (Laser, Detector, Modulators) Photonics and Electronics Integration Photonic Interconnects Optical Multiplexing Switch Fabrics and Routers Silicon Photonics for Sensing
Literatur	 Graham T. Reed, Andrew Knights, Silicon Photonics - An Introduction, John Wiley & Sons Ltd (2004) Clifford R. Pollocka and Michal Lipson, Integrated Photonics, Springer-Verlag (2003) Sami Franssila, Introduction to microfabrication, Chichester, West Sussex Wiley (2010) Dominik G. Rabus, Integrated Ring Resonators: The Compendium, in Springer Series in Optical Sciences (2007)

ehrveranstaltung L2418: Silicon Photonics			
Тур	Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung		
sws	2		
LP	2		
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 32, Präsenzstudium 28		
Dozenten	Dr. Timo Lipka		
Sprachen	EN		
Zeitraum	WiSe		
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung		
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung		

Modul M0925: Digital	Circuit Design				
Lehrveranstaltungen					
Titel		Тур	sws	LP	
Entwurf Digitaler Schaltungen (L069	98)	Vorlesung	2	3	
Erweiterter Digitaler Schaltungsent	wurf (L0699)	Vorlesung	2	3	
Modulverantwortlicher	Prof. Matthias Kuhl				
Zulassungsvoraussetzungen	None				
Empfohlene Vorkenntnisse					
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben	die Studierenden die folgenden Lernergebnisse err	eicht		
Lernergebnisse					
Fachkompetenz					
Wissen					
Fertigkeiten					
Personale Kompetenzen					
Sozialkompetenz					
Selbstständigkeit					
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 124, Präsenzstudium 5	56			
Leistungspunkte	6				
Studienleistung	Keine				
Prüfung	Mündliche Prüfung				
Prüfungsdauer und -umfang	40 min				
Zuordnung zu folgenden	Elektrotechnik: Vertiefung Nanoelekt	ronik und Mikrosystemtechnik: Wahlpflicht			
Curricula	Internationales Wirtschaftsingenieur	wesen: Vertiefung II. Elektrotechnik: Wahlpflicht			
	Mechanical Engineering and Manager	ment: Vertiefung Mechatronik: Wahlpflicht			
	Microelectronics and Microsystems: \	Vertiefung Microelectronics Complements: Wahlpfli	cht		
	Microelectronics and Microsystems: \	Vertiefung Embedded Systems: Wahlpflicht			

Lehrveranstaltung L0698: Digital Circuit Design			
Тур	Vorlesung		
SWS	2		
LP	3		
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28		
Dozenten	Prof. Volkhard Klinger		
Sprachen	EN		
Zeitraum	WiSe		
Inhalt			
Literatur			

Lehrveranstaltung L0699: Advanced Digital Circuit Design				
Тур	rlesung			
sws	2			
LP	3			
Arbeitsaufwand in Stunden	enstudium 62, Präsenzstudium 28			
Dozenten	Prof. Volkhard Klinger			
Sprachen	EN			
Zeitraum	SoSe			
Inhalt				
Literatur				

Microsystems"					
Modul M0921: Electro	nic Circuits for	Medical Application	ons		
Lehrveranstaltungen					
Titel			Тур	SWS	LP
Medizinelektronik (L0696)			Vorlesung	2	3
Medizinelektronik (L1056)			Gruppenübung Laborpraktikum	1 1	2
Medizinelektronik (L1408)	But Marilla R M		Laborpraktikum	1	1
Modulverantwortlicher					
Zulassungsvoraussetzungen					
Empfohlene Vorkenntnisse			anden die felgenden Lernergebnisse err	oicht	
Lernergebnisse	Nach endigreicher Teil	manine naben die Studiere	enden die folgenden Lernergebnisse err	eicht	
Fachkompetenz					
Wissen	Students can ex Students are ab Students can ex Students can de Students can ex	ole to explain the build-up of exemplify the communication escribe the special features explain the functions of pros	ty of the information transfer by the celof an action potential and its propagation between neurons and electronic devices of low-noise amplifiers for medical applitheses, e. g. an artificial hand and limitations of cochlea implants and	on along an axon ces olications	
Fertigkeiten	 Students can calculate the time dependent voltage behavior of an action potential Students can give scenarios for further improvement of low-noise and low-power signal acquisition. Students can develop the block diagrams of prosthetic systems Students can define the building blocks of electronic systems for an articifial eye. 				
Personale Kompetenzen Sozialkompetenz	Students are tr professional bac Students are ab	ckground. ble to recognize their speciocument their work in a c	n the field of medical electronics in t fic limitations, so that they can ask for a lear manner and communicate their re	assistance to the right	t time.
Selbstständigkeit	Students are a necessary. Students can br Students can ha	reak down their work in ap andle the complex data str	the status of their knowledge and to propriate work packages and schedule uctures of bioelectrical experiments with manner in all cases and situations of ex	their work in a realisti	ic way.
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 124, Prä	isenzstudium 56			
Leistungspunkte	6				
Studienleistung Prüfung	Verpflichtend Bonus Ja Keiner Nein Keiner Klausur	Art der Studienleistung Fachtheoretisch- fachpraktische Studienleistung Übungsaufgaben	Beschreibung		
	1				
Prüfungsdauer und -umfang			6.1		
Zuordnung zu folgenden		fung Medizintechnik: Wahl		GI L	
Curricula	_		rgane und Regenerative Medizin: Wahl	oflicht	
	Mediziningenieurwesen: Vertiefung Implantate und Endoprothesen: Wahlpflicht				
	_	n: Vertiefung Medizin- und			
	Mediziningenieurwesen: Vertiefung Management und Administration: Wahlpflicht				
	Microelectronics and Microsystems: Vertiefung Microelectronics Complements: Wahlpflicht				
	Theoretischer Maschin	enbau: Vertiefung Bio- und	d Medizintechnik: Wahlpflicht		

Lehrveranstaltung L0696: El	ectronic Circuits for Medical Applications
Тур	Vorlesung
SWS	2
LP	3
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28
Dozenten	Prof. Matthias Kuhl
Sprachen	EN
Zeitraum	WiSe
Inhalt	 Market for medical instruments Membrane potential, action potential, sodium-potassium pump Information transfer by the central nervous system Interface tissue - electrode Amplifiers for medical applications, analog-digital converters Examples for electronic implants Artificial eye, cochlea implant
Literatur	Kim E. Barret, Susan M. Barman, Scott Boitano and Heddwen L. Brooks Ganong's Review of Medical Physiology, 24nd Edition, McGraw Hill Lange, 2010 Tier- und Humanphysiologie: Eine Einführung von Werner A. Müller (Author), Stephan Frings (Author), 657 p., 4. editions, Springer, 2009 Robert F. Schmidt (Editor), Hans-Georg Schaible (Editor) Neuro- und Sinnesphysiologie (Springer-Lehrbuch) (Paper back), 488 p., Springer, 2006, 5. Edition, currently online only Russell K. Hobbie, Bradley J. Roth, Intermediate Physics for Medicine and Biology, Springer, 4th ed., 616 p., 2007 Vorlesungen der Universität Heidelberg zur Tier- und Humanphysiologie: http://www.sinnesphysiologie.de/gruvo03/gruvoin.htm Internet: http://butler.cc.tut.fi/~malmivuo/bem/bembook/

ehrveranstaltung L1056: Electronic Circuits for Medical Applications		
Тур	Gruppenübung	
sws	1	
LP	2	
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 46, Präsenzstudium 14	
Dozenten	Prof. Matthias Kuhl	
Sprachen	EN	
Zeitraum	WiSe	
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung	
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung	

Lehrveranstaltung L1408: El	ectronic Circuits for Medical Applications			
Тур	Laborpraktikum			
sws	1			
LP	1			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 16, Präsenzstudium 14			
Dozenten	of. Matthias Kuhl			
Sprachen	EN			
Zeitraum	WiSe			
Inhalt	 Market for medical instruments Membrane potential, action potential, sodium-potassium pump Information transfer by the central nervous system Interface tissue - electrode Amplifiers for medical applications, analog-digital converters Examples for electronic implants Artificial eye, cochlea implant 			
Literatur	Kim E. Barret, Susan M. Barman, Scott Boitano and Heddwen L. Brooks Ganong's Review of Medical Physiology, 24nd Edition, McGraw Hill Lange, 2010 Tier- und Humanphysiologie: Eine Einführung von Werner A. Müller (Author), Stephan Frings (Author), 657 p., 4. editions, Springer, 2009 Robert F. Schmidt (Editor), Hans-Georg Schaible (Editor) Neuro- und Sinnesphysiologie (Springer-Lehrbuch) (Paper back), 488 p., Springer, 2006, 5. Edition, currently online only Russell K. Hobbie, Bradley J. Roth, Intermediate Physics for Medicine and Biology, Springer, 4th ed., 616 p., 2007 Vorlesungen der Universität Heidelberg zur Tier- und Humanphysiologie: http://www.sinnesphysiologie.de/gruvo03/gruvoin.htm Internet: http://butler.cc.tut.fi/~malmivuo/bem/bembook/			

Merosystems					
Modul M0769: EMV I:	Kopplungen, Gegenmaßna	ahmen und Prüfve	erfahren		
Lehrveranstaltungen					
Titel			Тур	sws	LP
EMV I: Kopplungen, Gegenmaßnahr	nen und Prüfverfahren (L0743)		Vorlesung	3	4
EMV I: Kopplungen, Gegenmaßnahr	nen und Prüfverfahren (L0744)		Gruppenübung	1	1
EMV I: Kopplungen, Gegenmaßnahr	nen und Prüfverfahren (L0745)		Laborpraktikum	1	1
Modulverantwortlicher	Prof. Christian Schuster				
Zulassungsvoraussetzungen	Keine				
Empfohlene Vorkenntnisse	Grundlagen der Elektrotechnik				
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben d	lie Studierenden die folge	nden Lernergebnisse err	eicht	
Lernergebnisse					
Fachkompetenz					
Wissen	Die Studierenden können die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten, Zusammenhänge und Methoden der Elektromagnetischer Verträglichkeit elektrischer und elektronischer Systeme erklären und in den Kontext des störungsfreien Aufbaus und des Nachweises der Elektromagnetischen Verträglichkeit solcher Systeme setzen. Sie können die verschiedenen Störquellen und Koppelpfade klassifizieren und erläutern. Sie können passive Entstörkonzepte für Probleme der Elektromagnetischer Verträglichkeit vorschlagen und beschreiben. Sie können einen Überblick über messtechnische und numerische Methoden zu Sicherstellung der Elektromagnetischen Verträglichkeit in der elektrotechnischen Praxis geben.				
Fertigkeiten	Die Studierenden können eine Reihe von Verfahren zur Modellbildung der Elektromagnetischen Verträglichkeit typischer elektrischer und elektronischer Systeme anwenden. Sie können einschätzen, welche prinzipiellen Effekte diese Modelle in Bezug auf die Elektromagnetische Verträglichkeit vorhersagen, können diese klassifizieren und quantitativ analysieren. Sie können Lösungsstrategien aus diesen Vorhersagen ableiten und für die Anwendung in der elektrotechnischen Praxis dimensionieren. Sie können verschiedene Lösungsstrategien gegeneinander abwägen.				
Personale Kompetenzen					
•	Die Studierenden können in kleinen Gruppen fachspezifische Aufgaben gemeinsam bearbeiten und Ergebnisse in geeigneter Weise auf Englisch präsentieren, etwa während der praktischen Versuche und Übungen.				
Selbstständigkeit	Die Studierenden sind in der Lage, die notwendigen Informationen aus den angegebenen Literaturquellen zu beschaffen und in den Kontext der Vorlesung zu setzen. Sie können ihr erlangtes Wissen mit den Inhalten anderer Lehrveranstaltungen (z.B. Theoretischer Elektrotechnik und Nachrichtentechnik) verknüpfen. Sie können Probleme und Lösungen im Bereich der Elektromagnetischen Verträglichkeit auf Englisch kommunizieren.				
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 110, Präsenzstudium 70)			
Leistungspunkte	6				
Studienleistung	Verpflichtend Bonus Art der Studienlei Ja Keiner Referat	istung Beschreibung			
Prüfuna	Mündliche Prüfung				
Prüfungsdauer und -umfang	•				
		. Optik und Elektromagne	tische Verträglichkeit: W	ahlpflicht	
	Elektrotechnik: Vertiefung HF-Technik, Optik und Elektromagnetische Verträglichkeit: Wahlpflicht Mechatronics: Technischer Ergänzungskurs: Wahlpflicht				
Sarricula	Microelectronics and Microsystems: Ve	·	Complements: Wahlpfli	cht	
		. 5	,		

Lehrveranstaltung L0743: EN	VV I: Kopplungen, Gegenmaßnahmen und Prüfverfahren			
	priesung			
SWS	3			
LP	4			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 78, Präsenzstudium 42			
Dozenten	Prof. Christian Schuster			
Sprachen	DE/EN			
Zeitraum	SoSe			
Inhalt	 Einführung in die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Störquellen in Zeit- und Frequenzbereich Kopplungsmechanismen Leitungen und ihre Kopplung an elektromagnetische Felder Schirmung Filter EMV-Prüfverfahren 			
Literatur	 C.R. Paul: "Introduction to Electromagnetic Compatibility", 2nd ed., (Wiley, New Jersey, 2006). A.J. Schwab und W. Kürner: "Elektromagnetische Verträglichkeit", 6. Auflage, (Springer, Berlin 2010). F.M. Tesche, M.V. Ianoz, and T. Karlsson: "EMC Analysis Methods and Computational Models", (Wiley, New York, 1997). 			

Lehrveranstaltung L0744: EN	4V I: Kopplungen, Gegenmaßnahmen und Prüfverfahren			
Тур	ruppenübung			
sws	1			
LP	1			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 16, Präsenzstudium 14			
Dozenten	Prof. Christian Schuster			
Sprachen	DE/EN			
Zeitraum	oSe			
Inhalt	Die Übung dient der Vertiefung und Einübung der Vorlesungsinhalte.			
Literatur	 C.R. Paul: "Introduction to Electromagnetic Compatibility", 2nd ed., (Wiley, New Jersey, 2006). A.J. Schwab und W. Kürner: "Elektromagnetische Verträglichkeit", 6. Auflage, (Springer, Berlin 2010). F.M. Tesche, M.V. Ianoz, and T. Karlsson: "EMC Analysis Methods and Computational Models", (Wiley, New York, 1997). Scientific articles and papers 			

Lehrveranstaltung L0745: EN	NV I: Kopplungen, Gegenmaßnahmen und Prüfverfahren
Тур	Laborpraktikum
sws	1
LP	1
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 16, Präsenzstudium 14
Dozenten	Prof. Christian Schuster
Sprachen	DE/EN
Zeitraum	SoSe
Inhalt	Mit Hilfe von Laborversuchen werden die folgenden Themenfelder der EMV praktisch untersucht:
	 Schirmung Leitungsgeführte EMV-Prüfverfahren Die GTEM-Zelle als feldgebundene Prüfumgebung
Literatur	Versuchsbeschreibungen und zugehörige Literatur werden innerhalb der Veranstaltung bereit gestellt.

Modul M1743: COSIMA	A (Competition in Microsysto	em Application)			
Lehrveranstaltungen					
Titel COSIMA (Competition in Microsystem Application) (L3094)			Typ Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung	SWS 5	LP 6
Modulverantwortlicher	Prof. Hoc Khiem Trieu				
Zulassungsvoraussetzungen	None				
Empfohlene Vorkenntnisse					
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die	Studierenden die folgen	den Lernergebnisse erreicht		
Lernergebnisse					
Fachkompetenz					
Wissen					
Fertigkeiten					
Personale Kompetenzen					
Sozialkompetenz					
Selbstständigkeit					
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 110, Präsenzstudium 70				
Leistungspunkte	6				
Studienleistung	Keine				
Prüfung	Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit				
Prüfungsdauer und -umfang	60 Minuten				
Zuordnung zu folgenden	Microelectronics and Microsystems: Vert	iefung Microelectronics C	Complements: Wahlpflicht		
Curricula	Microelectronics and Microsystems: Vert	iefung Microelectronics C	Complements: Wahlpflicht		
	Microelectronics and Microsystems: Vert	iefung Communication a	nd Signal Processing: Wahlp	flicht	
	Microelectronics and Microsystems: Vert	iefung Communication a	nd Signal Processing: Wahlp	flicht	
	Microelectronics and Microsystems: Vert	iefung Embedded Systen	ns: Wahlpflicht		
	Microelectronics and Microsystems: Vert	iefung Embedded Systen	ns: Wahlpflicht		

Lehrveranstaltung L3094: COSIMA (Competition in Microsystem Application)			
Тур	ojekt-/problembasierte Lehrveranstaltung		
SWS			
LP			
Arbeitsaufwand in Stunden	genstudium 110, Präsenzstudium 70		
Dozenten	of. Hoc Khiem Trieu, Dozenten des Studiengangs		
Sprachen	EN		
Zeitraum	WiSe/SoSe		
Inhalt			
Literatur			

Modul M0919: Labora	tory: Digital Circuit Design		
Lehrveranstaltungen			
Titel Praktischer Schaltungsentwurf - Digital (L0694)		Typ Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung	SWS LP 2 6
Modulverantwortlicher	Prof. Matthias Kuhl		
Zulassungsvoraussetzungen	None		
Empfohlene Vorkenntnisse	Basic knowledge of semiconductor devices a	nd circuit design	
Modulziele/ angestrebte Lernergebnisse	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Stud	dierenden die folgenden Lernergebnisse erreicht	
Fachkompetenz			
Wissen	Students can explain the structure and Students can determine all necessary Students are able to explain the funct Students can explain the algorithms o	ions of the logic gates of their digital design.	
Fertigkeiten	Students can activate and execute all	necessary checking routines for verification of p ks for definition of their electronic circuits. s of digital systems.	proper circuit functionality.
Personale Kompetenzen Sozialkompetenz	 Students are trained to work through Students are able to share their knowl Students can help each other to under Students are aware of their limitation required. 		shead, but they involve experts whe
Selbstständigkeit	Students are able to realistically judencessary. Students can break down their design	dge the status of their knowledge and to de work in sub-tasks and can schedule the design a structures of their design task and document it tof work for a major design project.	work in a realistic way.
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 152, Präsenzstudium 28		
Leistungspunkte	6		
Studienleistung	Keine		
Prüfung	Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit		
Prüfungsdauer und -umfang			
Zuordnung zu folgenden	Elektrotechnik: Vertiefung Nanoelektronik un	· ·	
Curricula	Microelectronics and Microsystems: Vertiefur	ng Microelectronics Complements: Wahlpflicht	

Lehrveranstaltung L0694: La	aboratory: Digital Circuit Design
Тур	Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung
SWS	2
LP	6
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 152, Präsenzstudium 28
Dozenten	Prof. Matthias Kuhl
Sprachen	EN
Zeitraum	SoSe
Inhalt	 Definition of specifications Architecture studies Digital simulation flow Philosophy of standard cells Placement and routing of standard cells Layout generation Design checking routines
Literatur	Handouts will be distributed

Modul M0645: Fibre a	nd Integrated Ontics				
110001 110045. 1 1516 8	ind integrated optics				
Lehrveranstaltungen					
Titel		Тур	sws	LP	
Faseroptik und Integrierte Optik (LC	0363)	Vorlesung	2	3	
Faseroptik und Integrierte Optik (Ül	oung) (L0365)	Gruppenübung	1	1	
Modulverantwortlicher	Prof. Manfred Eich				
Zulassungsvoraussetzungen	None				
Empfohlene Vorkenntnisse	Basic principles of electrodynamics and	optics			
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die	Studierenden die folgenden Lernergebnisse erre	eicht		
Lernergebnisse					
Fachkompetenz					
Wissen	Students can explain the fundamental m	nathematical and physical relations and technolo	gical basics of guide	ed optical waves. They	
	can describe integrated optical as well as fibre optical structures. They can give an overview on the applications of int				
	optical components in optical signal prod	cessing.			
Fertiakeiten	Students can generate models and de	rive mathematical descriptions in relation to f	fibre ontical and in	tegrated ontical wave	
rerigienen	_	ative solutions and judge factors influential on the	•		
	personal components personal control of the page recess and components personal components				
Personale Kompetenzen					
Sozialkompetenz	Students can jointly solve subject related problems in groups. They can present their results effectively within the framework of				
	the problem solving course.				
Selbstständigkeit	· '	t information from the provided references and			
		uired level of expertise with the help of lecture			
	typical exam questions. Students are ab	le to connect their knowledge with that acquired	I from other lectures		
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 78, Präsenzstudium 42				
Leistungspunkte	4				
Studienleistung	Keine				
Prüfung	Klausur				
Prüfungsdauer und -umfang	60 Minuten				
Zuordnung zu folgenden	Elektrotechnik: Vertiefung HF-Technik, C	Optik und Elektromagnetische Verträglichkeit: Wa	ahlpflicht		
Curricula	Microelectronics and Microsystems: Vert	iefung Microelectronics Complements: Wahlpflic	ht		

Lehrveranstaltung L0363: Fibre and Integrated Optics	
Тур	Vorlesung
sws	2
LP	3
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28
Dozenten	Dr. Hagen Renner
Sprachen	EN
Zeitraum	SoSe
Inhalt	 Theory of optical waveguides Coupling to and from waveguides Losses Linear and nonlinear dspersion Components and technical applications
Literatur	Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich, Fundamentals of Photonics, Wiley 2007 Hunsperger, R.G., Integrated Optics: Theory and Technology, Springer, 2002 Agrawal, G.P.,Fiber-Optic Communication Systems, Wiley, 2002, ISBN 0471215716 Marcuse, D., Theory of Dielectric Optical Waveguides, Academic Press,1991, ISBN 0124709516 Tamir, T. (ed), Guided-Wave Optoelectronics, Springer, 1990

Lehrveranstaltung L0365: Fibre and Integrated Optics (Problem Solving Course)	
Тур	Gruppenübung
sws	1
LP	1
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 16, Präsenzstudium 14
Dozenten	Dr. Hagen Renner
Sprachen	EN
Zeitraum	SoSe
Inhalt	See lecture Fibre and Integrated Optics
Literatur	See lecture Fibre and Integrated Optics

Modul M0643: Optoel	ectronics I - Wave Optics				
Lehrveranstaltungen					
Titel		Тур	sws	LP	
Optoelektronik I: Wellenoptik (L035		Vorlesung	2	3	
Optoelektronik I: Wellenoptik (Übur		Gruppenübung	1	1	
Modulverantwortlicher	Dr. Alexander Petrov				
Zulassungsvoraussetzungen					
Empfohlene Vorkenntnisse	Basics in electrodynamics, calculus				
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Stud	ierenden die folgenden Lernergebnisse err	eicht		
Lernergebnisse					
Fachkompetenz					
Wissen	Students can explain the fundamental mathe			es.	
	They can give an overview on wave optical pl				
	Students can describe waveoptics based com	ponents such as electrooptical modulators	in an application ori	ented way.	
Fertigkeiten	7 Students can generate models and derive mathematical descriptions in relation to free optical wave propagation. They can derive approximative solutions and judge factors influential on the components' performance.				
Personale Kompetenzen Sozialkompetenz	z Students can jointly solve subject related problems in groups. They can present their results effectively within the framework of the problem solving course.				
Selbstständigkeit	Students are capable to extract relevant information from the provided references and to relate this information to the content of the lecture. They can reflect their acquired level of expertise with the help of lecture accompanying measures such as exam typical exam questions. Students are able to connect their knowledge with that acquired from other lectures.				
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 78, Präsenzstudium 42				
Leistungspunkte	4				
Studienleistung	Keine				
Prüfung					
Prüfungsdauer und -umfang	60 Minuten				
	Elektrotechnik: Vertiefung Nanoelektronik un	d Mikrosystemtechnik: Wahlpflicht			
	Elektrotechnik: Vertiefung HF-Technik, Optik		ahlpflicht		
	Materialwissenschaft: Vertiefung Nano- und F	•	•		
	Microelectronics and Microsystems: Vertiefun		cht		
	Regenerative Energien: Vertiefung Solare Ene	•			
	<u> </u>	<u> </u>			

Lehrveranstaltung L0359: Optoelectronics I: Wave Optics			
Тур	Vorlesung		
SWS	!		
LP	3		
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28		
Dozenten	Dr. Alexander Petrov		
Sprachen	EN		
Zeitraum	SoSe		
Inhalt	 Introduction to optics Electromagnetic theory of light Interference Coherence Diffraction Fourier optics Polarisation and Crystal optics Matrix formalism Reflection and transmission Complex refractive index Dispersion Modulation and switching of light 		
Literatur	Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich, Fundamentals of Photonics, Wiley 2007 Hecht, E., Optics, Benjamin Cummings, 2001 Goodman, J.W. Statistical Optics, Wiley, 2000 Lauterborn, W., Kurz, T., Coherent Optics: Fundamentals and Applications, Springer, 2002		

Lehrveranstaltung L0361: Op	ehrveranstaltung L0361: Optoelectronics I: Wave Optics (Problem Solving Course)			
Тур	Gruppenübung			
sws	1			
LP	1			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 16, Präsenzstudium 14			
Dozenten	Alexander Petrov			
Sprachen	EN			
Zeitraum	SoSe			
Inhalt	see lecture Optoelectronics 1 - Wave Optics			
Literatur	see lecture Optoelectronics 1 - Wave Optics			

Modul M1688: Selecte	ed Aspects of Microelectronics a	nd Microsystems		
Lehrveranstaltungen				
Titel		Тур	sws	LP
Ausgewählte Aspekte der Mikroelek	ctronik und Mikrosysteme (L2678)	Vorlesung	3	4
Ausgewählte Aspekte der Mikroelek	ctronik und Mikrosysteme (L2679)	Gruppenübung	1	2
Modulverantwortlicher	Prof. Hoc Khiem Trieu			
Zulassungsvoraussetzungen	None			
Empfohlene Vorkenntnisse				
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studie	renden die folgenden Lernergebnisse erre	eicht	
Lernergebnisse				
Fachkompetenz				
Wissen				
Fertigkeiten				
Personale Kompetenzen				
Sozialkompetenz				
Selbstständigkeit				
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 124, Präsenzstudium 56			
Leistungspunkte	6			
Studienleistung	Keine			
Prüfung	Mündliche Prüfung			
Prüfungsdauer und -umfang	30 min			
Zuordnung zu folgenden	Microelectronics and Microsystems: Vertiefung Microelectronics Complements: Wahlpflicht			
Curricula				

Lehrveranstaltung L2678: Se	ehrveranstaltung L2678: Selected Aspects of Microelectronics and Microsystems			
Тур	Vorlesung			
sws	3			
LP	4			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 78, Präsenzstudium 42			
Dozenten	Dozenten des SD E			
Sprachen	EN			
Zeitraum	WiSe/SoSe			
Inhalt				
Literatur				

Lehrveranstaltung L2679: Se	ehrveranstaltung L2679: Selected Aspects of Microelectronics and Microsystems		
Тур	Gruppenübung		
SWS	1		
LP	2		
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 46, Präsenzstudium 14		
Dozenten	Dozenten des SD E		
Sprachen	EN		
Zeitraum	WiSe/SoSe		
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung		
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung		

	Signalintegrität und Span	nangsversorgan	3		
Lehrveranstaltungen					
Titel			Тур	SWS	LP
EMV II: Signalintegrität und Spannu	ngsversorgung elektronischer Systeme (L03	770)	Vorlesung	3	4
EMV II: Signalintegrität und Spannu	ngsversorgung elektronischer Systeme (LO	771)	Gruppenübung	1	1
EMV II: Signalintegrität und Spannu	ngsversorgung elektronischer Systeme (L0	774)	Laborpraktikum	1	1
Modulverantwortlicher	Prof. Christian Schuster				
Zulassungsvoraussetzungen	Keine				
Empfohlene Vorkenntnisse	Grundlagen der Elektrotechnik				
_	Nach erfolgreicher Teilnahme haben di	e Studierenden die folge	enden Lernergebnisse er	reicht	
Lernergebnisse					
Fachkompetenz	Die Studierenden können die grundle				
	Güte der Spannungsversorgung (Powe bzw. der elektromagnetischen Verträg Spannungsversorgung vor dem Hir Lösungsstrategien für Probleme der S messtechnische und numerische Meth geben.	llichkeit solcher System ntergrund der typisch ignal- und Powerintegrit	e setzen. Sie können da en Aufbau- und Verb ät vorschlagen und bes	as prinzipielle Verhalt indungstechnik erläu chreiben. Sie können	en von Signalen u utern. Sie könn einen Überblick üb
Fertigkeiten	Die Studierenden können eine Reihe von Verfahren zur Modellbildung zur Beschreibung des elektromagnetischen Verhaltens typischer Aufbau- und Verbindungstechnik elektronischer Systeme anwenden. Sie können einschätzen, welche prinzipieller Effekte diese Modelle in Bezug auf die Signal- und Powerintegrität vorhersagen, können diese klassifizieren und quantitativ analysieren. Sie können Lösungsstrategien aus diesen Vorhersagen ableiten und für die Anwendung in der elektrotechnischer Praxis dimensionieren. Sie können verschiedene Lösungsstrategien gegeneinander abwägen.				
Personale Kompetenzen					
	Die Studierenden können in kleinen Gruppen fachspezifische Aufgaben gemeinsam bearbeiten und Ergebnisse in geeignete Weise auf Englisch präsentieren (z.B. während der CAD-Übungen).				
Selbstständigkeit	Die Studierenden sind in der Lage, die notwendigen Informationen aus den angegebenen Literaturquellen zu beschaffen und ir den Kontext der Vorlesung zu setzen. Sie können ihr erlangtes Wissen mit den Inhalten anderer Lehrveranstaltungen (z.B. Theoretischer Elektrotechnik, Nachrichtentechnik und Halbleiterschaltungstechnik) verknüpfen. Sie können Probleme und Lösungen im Bereich der Signal- und Powerintegrität der Aufbau- und Verbindungstechnik auf Englisch kommunizieren.				
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 110, Präsenzstudium 70				
Leistungspunkte	6				
Studienleistung	Verpflichtend Bonus Art der Studienleis a Keiner Referat	Stung Beschreibung			
Prüfung	Mündliche Prüfung				
Prüfungsdauer und -umfang	•				
	Elektrotechnik: Vertiefung HF-Technik,	Optik und Elektromagne	etische Verträglichkeit [.] W	/ahlpflicht	
	Elektrotechnik: Vertiefung Nanoelektro		-		
Carricula	Mechatronics: Technischer Ergänzungs	•			
	Microelectronics and Microsystems: Ve		Complements: Wahlnfli	cht	

	//VII: Signalintegrität und Spannungsversorgung elektronischer Systeme			
	Vorlesung			
SWS				
LP				
	Eigenstudium 78, Präsenzstudium 42			
	Prof. Christian Schuster			
Sprachen				
Zeitraum				
Inhalt	- Die Rolle von Packages und Interconnects in elektronischen Systemen			
	- Komponenten der Aufbau- und Verbindungstechnik elektronischer Systeme			
	- Hauptziele und Konzepte der Signal- und Powerintegrität elektronischer Systeme			
	- Wiederholung relevanter Konzepte der elektromagnetischen Feldtheorie			
	Eigenschaften digitaler Signale und Systeme			
	Entwurf und Charakterisierung der Signalintegrität			
	- Entwurf und Charakterisierung der Spannungsversorgung			
	- Techniken und Geräte zur Messung in Zeit- und Frequenzbereich			
	- CAD-Werkzeuge für elektrische Analyse und Entwurf von Packages und Interconnects			
	- Bezug zur gesamten elektromagnetischen Verträglichkeit von elektronischen Systemen			
Literatur	- J. Franz, "EMV: Störungssicherer Aufbau elektronischer Schaltungen", Springer (2012)			
	- R. Tummala, "Fundamentals of Microsystems Packaging", McGraw-Hill (2001)			
	- S. Ramo, J. Whinnery, T. Van Duzer, "Fields and Waves in Communication Electronics", Wiley (1994)			
	- S. Thierauf, "Understanding Signal Integrity", Artech House (2010)			
	- M. Swaminathan, A. Engin, "Power Integrity Modeling and Design for Semiconductors and Systems", Prentice-Hall (2007)			

Lehrveranstaltung L0771: EN	ehrveranstaltung L0771: EMV II: Signalintegrität und Spannungsversorgung elektronischer Systeme			
Тур	Gruppenübung			
sws	1			
LP	1			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 16, Präsenzstudium 14			
Dozenten	Prof. Christian Schuster			
Sprachen	DE/EN			
Zeitraum	WiSe			
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung			
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung			

Тур	Laborpraktikum			
sws				
LP	1			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 16, Präsenzstudium 14			
Dozenten	Prof. Christian Schuster			
Sprachen	DE/EN			
Zeitraum	WiSe			
Inhalt	- Die Rolle von Packages und Interconnects in elektronischen Systemen			
	- Komponenten der Aufbau- und Verbindungstechnik elektronischer Systeme			
	- Hauptziele und Konzepte der Signal- und Powerintegrität elektronischer Systeme			
	- Wiederholung relevanter Konzepte der elektromagnetischen Feldtheorie			
	- Eigenschaften digitaler Signale und Systeme			
	intwurf und Charakterisierung der Signalintegrität			
	- Entwurf und Charakterisierung der Spannungsversorgung			
	- Techniken und Geräte zur Messung in Zeit- und Frequenzbereich			
	- CAD-Werkzeuge für elektrische Analyse und Entwurf von Packages und Interconnects			
	Bezug zur gesamten elektromagnetischen Verträglichkeit von elektronischen Systemen			
Literatur	- J. Franz, "EMV: Störungssicherer Aufbau elektronischer Schaltungen", Springer (2012)			
	- R. Tummala, "Fundamentals of Microsystems Packaging", McGraw-Hill (2001)			
	- S. Ramo, J. Whinnery, T. Van Duzer, "Fields and Waves in Communication Electronics", Wiley (1994)			
	- S. Thierauf, "Understanding Signal Integrity", Artech House (2010)			
	- M. Swaminathan, A. Engin, "Power Integrity Modeling and Design for Semiconductors and Systems", Prentice-Hall (2007)			

Microsystems						
Modul M0913: Mixed-	signal Circuit D	esign				
Lehrveranstaltungen						
Titel Mixed-signal Schaltungsentwurf (L0 Mixed-signal Schaltungsentwurf (L1				Typ Vorlesung Projekt-/problembasierte	SWS 2 2	LP 3 3
Mandada and a sanda and the land	Dunk Matthian Kulal			Lehrveranstaltung		
Modulverantwortlicher Zulassungsvoraussetzungen						
Empfohlene Vorkenntnisse		of analog or digital MOS	devices and circui	ts		
Modulziele/ angestrebte Lernergebnisse				den Lernergebnisse erreich	t	
Fachkompetenz						
Wissen	Students can e		es of analog-to-di	-signal systems gital and digital-to-analog c of different analog-to-digital		alog converters
Fertigkeiten	 Students can derive the fundamental limitations of different analog-to-digital and digital-to-analog converters Students can select the most suitable architecture for a specific mixed-signal task Students can describe complex mixed-signal systems by their functional blocks. Students can calculate the specifications of mixed-signal circuits 					
Personale Kompetenzen Sozialkompetenz	 Students can team up with one or several partners who may have different professional backgrounds Students are able to work by their own or in small groups for solving problems and answer scientific questions. 					
Selbstständigkeit	 Students are able to assess their knowledge in a realistic manner. Students are able to draw scenarios for estimation of the impact of an increase of data vs. an increase of energy on the future lifestyle of the society. 					
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 124, Pra	isenzstudium 56				
Leistungspunkte	6			_		
Studienleistung	Verpflichtend Bonus Ja 5 %	Art der Studienleistung Fachtheoretisch- fachpraktische Studienleistung	Beschreibung			
Prüfung	Klausur					
Prüfungsdauer und -umfang	90 min					
Zuordnung zu folgenden Curricula		-	•	nik: Wahlpflicht Complements: Wahlpflicht		

Lehrveranstaltung L0764: Mi	ixed-signal Circuit Design
Тур	Vorlesung
sws	2
LP	3
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28
Dozenten	Prof. Matthias Kuhl
Sprachen	EN
Zeitraum	WiSe
Inhalt	 Differences between analog and digital filtering of electrical signals Quantization error and its consideration in electrical circuits Architectures of state-of-the-art digital-to-analog converters Architectures of state-of-the-art analog-to-digital converters Differentiation between Nyquist and oversampling converters noise in ADCs and DACs
Literatur	 R. J. Baker, "CMOS-Circuit Design, Layout, and Simulation", Wiley & Sons, IEEE Press, 2010 B. Razavi, "Design of Analog CMOS Integrated Circuits", McGraw-Hill Education Ltd, 2000

Modulhandbuch M.Sc. "Microelectronics and Microsystems"

Lehrveranstaltung L1063: M	ehrveranstaltung L1063: Mixed-signal Circuit Design	
Тур	Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung	
sws	2	
LP	3	
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28	
Dozenten	Prof. Matthias Kuhl	
Sprachen	EN	
Zeitraum	WiSe	
Inhalt	Siehe korrespondierende Vorlesung	
Literatur	Siehe korrespondierende Vorlesung	

Medul M1590: Labora	tomu Angles Circuit Basis			
Modul M1589: Labora	tory: Analog Circuit Design			
Lehrveranstaltungen				
Titel		Тур	sws	LP
Praktischer Schaltungsentwurf - And	alog (L0692)	Projekt-/problembasierte	2	6
		Lehrveranstaltung		
Modulverantwortlicher	Prof. Matthias Kuhl			
Zulassungsvoraussetzungen	None			
Empfohlene Vorkenntnisse	Basic knowledge of semiconductor devices	s and circuit design		
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die St	tudierenden die folgenden Lernergebnisse erreich	t	
Lernergebnisse				
Fachkompetenz				
Wissen				
		and philosophy of the software framework for circ	uit design.	
		ry input parameters for circuit simulation.		
	Students know the basics physics of			
	Students can explain the algorithms			
	 Students are able to select the appr 	opriate transistor models for fast and accurate si	mulations.	
Fertigkeiten				
Tertigkeiteit	 Students can activate and execute a 	all necessary checking routines for verification of	proper circuit func	tionality.
	 Students can define the specificatio 	ns of the electronic circuits to be designed.		
	Students can optimize the electronic	c circuits for low-noise and low-power.		
	 Students can develop analog circuit 	s for specific applications.		
Personale Kompetenzen Sozialkompetenz	 Students are trained to work throug Students are able to share their kno 			
			aaftwara	
		derstand all the details and options of the design size regarding circuit design, so they do not go		avalva avports who
		ions regarding circuit design, so they do not go	anead, but they i	ivoive experts wher
	required.	pproaches for easy checking by more experience	d ovports	
	• Students can present their design a	pproacties for easy checking by more experience	u experts.	
Selbstständigkeit	Students are able to realistically	judge the status of their knowledge and to d	efine actions for	improvements wher
	necessary.			
	 Students can break down their design 	gn work in sub-tasks and can schedule the design	work in a realistic	way.
	Students can handle the complex da	ata structures of their design task and document	it in consice but ur	nderstandable way.
	 Students are able to judge the amount 	unt of work for a major design project.		
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 152, Präsenzstudium 28			
Leistungspunkte	6			
Studienleistung				
Prüfung	Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit			
Prüfungsdauer und -umfang	30 min			
Zuordnung zu folgenden	Elektrotechnik: Vertiefung Nanoelektronik	und Mikrosystemtechnik: Wahlpflicht		
Curricula	Microelectronics and Microsystems: Vertief	fung Microelectronics Complements: Wahlpflicht		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		

Lehrveranstaltung L0692: Laboratory: Analog Circuit Design		
Тур	Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung	
SWS	2	
LP	6	
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 152, Präsenzstudium 28	
Dozenten	Prof. Matthias Kuhl, Weitere Mitarbeiter	
Sprachen	EN	
Zeitraum	WiSe	
Inhalt	 Input desk for circuits Algorithms for simulation MOS transistor model Simulation of analog circuits Placement and routing Generation of layouts Design checking routines Postlayout simulations 	
Literatur	Handouts to be distributed	

Hierosystems					
Modul M0644: Optoel	ectronics II - Quantum Opti	cs			
Lehrveranstaltungen					
Titel		Тур		sws	LP
Optoelektronik II: Quantenoptik (L0	360)	Vorlesung		2	3
Optoelektronik II: Quantenoptik (Üb	oung) (L0362)	Gruppenübur	ng	1	1
Modulverantwortlicher	Dr. Alexander Petrov				
Zulassungsvoraussetzungen	None				
Empfohlene Vorkenntnisse	Basic principles of electrodynamics, opt	tics and quantum mechanics			
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die	e Studierenden die folgenden Lernerge	ebnisse erreicht		
Lernergebnisse					
Fachkompetenz					
Wissen	Students can explain the fundamental mathematical and physical relations of quantum optical phenomena such as absorption stimulated and spontaneous emission. They can describe material properties as well as technical solutions. They can give a overview on quantum optical components in technical applications.				
Fertigkeiten	Students can generate models and derive mathematical descriptions in relation to quantum optical phenomena and processes. They can derive approximative solutions and judge factors influential on the components' performance.				
Personale Kompetenzen					
Sozialkompetenz	Students can jointly solve subject relat the problem solving course.	ted problems in groups. They can pre	sent their results eff	fectively wit	hin the framework
Selbstständigkeit	Students are capable to extract relevant information from the provided references and to relate this information to the content the lecture. They can reflect their acquired level of expertise with the help of lecture accompanying measures such as exa typical exam questions. Students are able to connect their knowledge with that acquired from other lectures.				
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 78, Präsenzstudium 42				
Leistungspunkte	4				
Studienleistung	Keine				
Prüfung	Klausur				
Prüfungsdauer und -umfang	60 Minuten				
	Elektrotechnik: Vertiefung Nanoelektro	nik und Mikrosystemtechnik: Wahlpflic	:ht		
	Elektrotechnik: Vertiefung HF-Technik,				
	Materialwissenschaft: Vertiefung Nano-	und Hybridmaterialien: Wahlpflicht			
	Microelectronics and Microsystems: Ver	rtiefung Microelectronics Complement	s: Wahlpflicht		

Lehrveranstaltung L0360: Optoelectronics II: Quantum Optics		
Тур	Vorlesung	
SWS	2	
LP	3	
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 62, Präsenzstudium 28	
Dozenten	Dr. Alexander Petrov	
Sprachen	EN	
Zeitraum	WiSe	
Inhalt	 Generation of light Photons Thermal and nonthermal light Laser amplifier Noise Optical resonators Spectral properties of laser light CW-lasers (gas, solid state, semiconductor) Pulsed lasers 	
Literatur	Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich, Fundamentals of Photonics, Wiley 2007 Demtröder, W., Laser Spectroscopy: Basic Concepts and Instrumentation, Springer, 2002 Kasap, S.O., Optoelectronics and Photonics: Principles and Practices, Prentice Hall, 2001 Yariv, A., Quantum Electronics, Wiley, 1988 Wilson, J., Hawkes, J., Optoelectronics: An Introduction, Prentice Hall, 1997, ISBN: 013103961X Siegman, A.E., Lasers, University Science Books, 1986	

ehrveranstaltung L0362: Optoelectronics II: Quantum Optics (Problem Solving Course)		
Тур	Gruppenübung	
SWS	1	
LP	1	
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 16, Präsenzstudium 14	
Dozenten	Dr. Alexander Petrov	
Sprachen	EN	
Zeitraum	WiSe	
Inhalt	see lecture Optoelectronics 1 - Wave Optics	
Literatur	see lecture Optoelectronics 1 - Wave Optics	

Modul M1743: COSIM	A (Competition in Microsystem Ap	pplication)		
Lehrveranstaltungen				
Titel COSIMA (Competition in Microsystem	m Application) (L3094)	Typ Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung	SWS 5	LP 6
Modulverantwortlicher	Prof. Hoc Khiem Trieu			
Zulassungsvoraussetzungen	None			
Empfohlene Vorkenntnisse	Knowledge of microsystems operation and applic	ation.		
-	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studiere	enden die folgenden Lernergebnisse erreicht		
Lernergebnisse				
Fachkompetenz Wissen	Consolidation of knowledge in the application of microsystems with practical relevance. Learning how an idea could turn into a		idea could turn into a	
	product.			
Fertigkeiten	Realization of a concrete system by integrating hardware components and, under certain circumstances, software into a demonstrator. Development of a business plan for the innovative product. Convincing companies to sponsor the project. Presentation of the project in the form of an exposé.			
Personale Kompetenzen				
Sozialkompetenz	Students work in groups of 3 to 4 participants ϵ group, taking into account the complementary sl		vision of tasks	takes place within the
Selbstständigkeit	The groups work on the project independently from the idea to the implementation. Supervision is provided through joint analysis of the problems and advice to the students.			
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 110, Präsenzstudium 70			
Leistungspunkte	6			
Studienleistung	Keine			
Prüfung	Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit			
Prüfungsdauer und -umfang	60 Minuten			
Zuordnung zu folgenden	Microelectronics and Microsystems: Vertiefung C	ommunication and Signal Processing: Wahlp	flicht	
Curricula	Microelectronics and Microsystems: Vertiefung E	· ·		
	Microelectronics and Microsystems: Vertiefung M	icroelectronics Complements: Wahlpflicht		

ehrveranstaltung L3094: COSIMA (Competition in Microsystem Application)		
Тур	Projekt-/problembasierte Lehrveranstaltung	
sws	5	
LP	6	
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 110, Präsenzstudium 70	
Dozenten	Prof. Hoc Khiem Trieu, Dozenten des Studiengangs	
Sprachen	EN	
Zeitraum	WiSe/SoSe	
Inhalt		
Literatur		

Thesis

Modul M-002: Mastera	arbeit
Lehrveranstaltungen	
Titel	Typ SWS LP
Modulverantwortlicher	
Zulassungsvoraussetzungen	
Zulassungsvoraussetzungen	• Laut ASPO § 21 (1):
	Er müssen mindestens 60 Leistungspunkte im Studiongang erwerben werden sein Über Ausnahmen entscheidet der
	Es müssen mindestens 60 Leistungspunkte im Studiengang erworben worden sein. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.
	Fruitungsausschuss.
Forestables - Mades outsides	
Empfohlene Vorkenntnisse	
Modulziele/ angestrebte	Nach erfolgreicher Teilnahme haben die Studierenden die folgenden Lernergebnisse erreicht
Lernergebnisse	
Fachkompetenz	
Wissen	• Die Studierenden können das Spezialwissen (Fakten, Theorien und Methoden) ihres Studienfaches sicher zur Bearbeitung
	fachlicher Fragestellungen einsetzen.
	Die Studierenden können in einem oder mehreren Spezialbereichen ihres Faches die relevanten Ansätze und Terminologien
	in der Tiefe erklären, aktuelle Entwicklungen beschreiben und kritisch Stellung beziehen.
	Die Studierenden können eine eigene Forschungsaufgabe in ihrem Fachgebiet verorten, den Forschungsstand erheben und
	kritisch einschätzen.
Fertigkeiten	Die Chadisanaden eind in den Lees für die inweilier frehliche Darblemetelland neuenwählen erwennen.
	Die Studierenden sind in der Lage, für die jeweilige fachliche Problemstellung geeignete Methoden auszuwählen Die Studierenden sind in der Lage, für die jeweilige fachliche Problemstellung geeignete Methoden auszuwählen Die Studierenden sind in der Lage, für die jeweilige fachliche Problemstellung geeignete Methoden auszuwählen Die Studierenden sind in der Lage, für die jeweilige fachliche Problemstellung geeignete Methoden auszuwählen Die Studierenden sind in der Lage, für die jeweilige fachliche Problemstellung geeignete Methoden auszuwählen Die Studierenden sind in der Lage, für die jeweilige fachliche Problemstellung geeignete Methoden auszuwählen Die Studierenden sind in der Lage, für die jeweilige fachliche Problemstellung geeignete Methoden auszuwählen Die Studierenden sind in der Lage, für die jeweilige fachliche Problemstellung geeignete Methoden auszuwählen Die Studierenden sind in der Lage, für die jeweilige fachliche Problemstellung geeignete Methoden auszuwählen Die Studierenden sind in der Lage, für die jeweilige fachliche Problemstellung geeignete Methoden auszuwählen Die Studierenden sind in der Lage, für die jeweilige fachliche Problemstellung geeignete Methoden auszuwählen Die Studierenden sind in der Lage, für die jeweilige fachliche Problemstellung geeignete Methoden auszuwählen geeignete Methoden gegen geeignete Methoden gegen gege
	anzuwenden und ggf. weiterzuentwickeln.
	 Die Studierenden sind in der Lage, im Studium erworbenes Wissen und erlernte Methoden auch auf komplexe und/ode unvollständig definierte Problemstellungen lösungsorientiert anzuwenden.
	 Die Studierenden können in ihrem Fachgebiet neue wissenschaftliche Erkenntnisse erarbeiten und diese kritisch beurteilen.
	bie Studierenden konnen in infern Fachgebiet nede wissenschaftliche Erkenntnisse eranbeiten und diese kritisch bediteilen.
Personale Kompetenzen	
	Studierende können
302Iaik0IIIpeteli2	Studierende konnen
	• eine wissenschaftliche Fragestellung für ein Fachpublikum sowohl schriftlich als auch mündlich strukturiert, verständlich
	und sachlich richtig darstellen.
	• in einer Fachdiskussion Fragen fachkundig und zugleich adressatengerecht beantworten und dabei eigene Einschätzungen
	überzeugend vertreten.
Selbstständigkeit	Studierende sind fähig,
	ein eigenes Projekt in Arbeitspakete zu strukturieren und abzuarbeiten.
	• sich in ein teilweise unbekanntes Arbeitsgebiet des Studiengangs vertieft einzuarbeiten und dafür benötigte Informationer
	zu erschließen.
	Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens umfassend in einer eigenen Forschungsarbeit anzuwenden.
Arbeitsaufwand in Stunden	Eigenstudium 900, Präsenzstudium 0
Leistungspunkte	30
Studienleistung	Keine
Prüfung	Abschlussarbeit
Prüfungsdauer und -umfang	laut ASPO
Zuordnung zu folgenden	Bauingenieurwesen: Abschlussarbeit: Pflicht
Curricula	Bioverfahrenstechnik: Abschlussarbeit: Pflicht
	Chemical and Bioprocess Engineering: Abschlussarbeit: Pflicht
	Computer Science: Abschlussarbeit: Pflicht
	Elektrotechnik: Abschlussarbeit: Pflicht
	Energietechnik: Abschlussarbeit: Pflicht
	Environmental Engineering: Abschlussarbeit: Pflicht
	Flugzeug-Systemtechnik: Abschlussarbeit: Pflicht
	Global Innovation Management: Abschlussarbeit: Pflicht
	Informatik-Ingenieurwesen: Abschlussarbeit: Pflicht
	Information and Communication Systems: Abschlussarbeit: Pflicht
	Interdisciplinary Mathematics: Abschlussarbeit: Pflicht

Modulhandbuch M.Sc. "Microelectronics and Microsystems"

International Production Management: Abschlussarbeit: Pflicht Internationales Wirtschaftsingenieurwesen: Abschlussarbeit: Pflicht

Joint European Master in Environmental Studies - Cities and Sustainability: Abschlussarbeit: Pflicht

Logistik, Infrastruktur und Mobilität: Abschlussarbeit: Pflicht

Materialwissenschaft: Abschlussarbeit: Pflicht

Mechanical Engineering and Management: Abschlussarbeit: Pflicht

Mechatronics: Abschlussarbeit: Pflicht

Mediziningenieurwesen: Abschlussarbeit: Pflicht

Microelectronics and Microsystems: Abschlussarbeit: Pflicht

Produktentwicklung, Werkstoffe und Produktion: Abschlussarbeit: Pflicht Regenerative Energien: Abschlussarbeit: Pflicht

Schiffbau und Meerestechnik: Abschlussarbeit: Pflicht
Ship and Offshore Technology: Abschlussarbeit: Pflicht
Teilstudiengang Lehramt Metalltechnik: Abschlussarbeit: Pflicht

Theoretischer Maschinenbau: Abschlussarbeit: Pflicht

Verfahrenstechnik: Abschlussarbeit: Pflicht

Wasser- und Umweltingenieurwesen: Abschlussarbeit: Pflicht

Zulassungs- und Sachverständigenwesen in der Luftfahrt: Abschlussarbeit: Pflicht